DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2006 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0002822834

WPI ACC NO: 1983-C5117K/

Re-structural integrated circuit with high gate density - has multiprocessor operated as lock-step or pipelined unit, and multilevel interrupt management system

Patent Assignee: TEXAS INSTR INC (TEXI)

Inventor: BUDZINSKI R L

Patent Family (4 patents, 5 countries)

Patent

Application

Number Kind Date N

Kind Date Number Kind Date Update

EP 71727 A 19830216 EP 1982105491 A 19820623 198308 B

198320 E

JP 58058672 A 19830407 EP 71727 B 19861001 E

B 19861001 EP 1982105491 A 19820623 198640 E

DE 3273549 G 19861106

198646 E

Priority Applications (no., kind, date): US 1981286426 A 19810724; US 1981286425 A 19810724; US 1981286424 A 19810724

Patent Details

Number Kind Lan Pg Dwg Filing Notes

EP 71727 A EN 28

Regional Designated States, Original: DE FR GB NL

EP 71727 B EN

Regional Designated States, Original: DE FR GB NL

Alerting Abstract EP A

The circuit has a monolithic substrate, having a number of 16-bit processors all accessing a common memory, busses including a status bus with synchronisation and arithmetic linkage lines. Each processor comprises a respective status bus multiplexer connected to the respective processor status bus. A bus control unit selectively connects the processor to the data bus or directly to a corresponding RAM memory module.

Each processor also contains interrupt manager which tests each successive interrupt signals to determine whether the respective processor which includes the interrupt manager is designated by the successive interrupt signal as an interrupter. The interrupt manager stores the priority of the one of the interrupt signals which initiated respective sequence of commands is currently being executed by the processor. The processors may be reconfigured programmably to operate independently in lock step or as pipelined processors.

Title Terms /Index Terms/Additional Words: STRUCTURE; INTEGRATE; CIRCUIT; HIGH; GATE; DENSITY; MULTIPROCESSOR; OPERATE; LOCK; STEP; PIPE; UNIT; MULTILEVEL; INTERRUPT; MANAGEMENT; SYSTEM

Class Codes

(Additional/Secondary): G06F-013/00, G06F-015/06, H01L-027/04

File Segment: EPI; DWPI Class: T01

Manual Codes (EPI/S-X): T01-F01; T01-F02; T01-J02

Original Publication Data by Authority

Germany

Publication No. DE 3273549 G (Update 198646 E)

Publication Date: 19861106

Language: DE

Priority: US 1981286424 A 19810724

US 1981286425 A 19810724 US 1981286426 A 19810724

EPO

Publication No. EP 71727 A (Update 198308 B)

Publication Date: 19830216

**Integrierte Schaltung mit aenderbarer Struktur

Restructurable integrated circuit Circuit integre restructurable**

Assignee: TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED, 13500 North Central Expressway,

Dallas Texas 75265, US (TEXI)

Inventor: Budzinski, Robert L., 1106 Edgewood Drive, Richardson Texas

75081, US

Agent: Leiser, Gottfried, Dipl.-Ing., et al, Patentanwaelte Prinz, Bunke

Partner Ernsberger Strasse 19, D-8000 Muenchen 60, DE

Language: EN (28 pages)

Application: EP 1982105491 A 19820623 (Local application)

Priority: US 1981286424 A 19810724

US 1981286425 A 19810724 US 1981286426 A 19810724

Designated States: (Regional Original) DE FR GB NL Original IPC: G06F-13/00 G06F-15/06 H01L-27/04 Current IPC: G06F-13/00 G06F-15/06 H01L-27/04

Original Abstract: Restructurable integrated circuit. A restructurable integrated circuit, including four 16-bit processors PRO, PR1, PR2, PR3, data and control memories 66 and 78, and external interfaces 72, 73, 74, 75, 76 all mounted on a chip. The processors include reconfigurable connections through a status bus 52, microprogramming capability with dynamic logic array interpretation, and a multi-level flexible interrupt management system, so that the processors PR0-PR3 may be reconfigured programmably to operate independently, in lockstep, or as pipelined processors. All processors PR0-PR3 are connected to data, control, and status busses 56, 14, and 52, in addition, external control, data, and status interfaces 72-76 are also provided, connected through the respective corresponding busses 56, 14, and 52 to each of the processors PR0-PR3. These external interfaces are connected to all of the interconnections which permit reconfigurability among the processors on a chip, and these external interfaces permit coordination of the processors on more than one RIC chip.

Publication No. EP 71727 B (Update 198640 E)

Publication Date: 19861001

**Integrierte Schaltung mit aenderbarer Struktur

Restructurable integrated circuit Circuit integre restructurable**

Assignee: TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED, 13500 North Central Expressway,

Dallas Texas 75265, US

Inventor: Budzinski, Robert L., 1106 Edgewood Drive, Richardson Texas

75081, US

Thatte, Satish M., 1304 Elk Grove, Richardson Texas 75081, US Agent: Leiser, Gottfried, Dipl.-Ing., et al, Patentanwaelte Prinz, Bunke

Partner Ernsberger Strasse 19, D-8000 Muenchen 60, DE

Language: EN

Application: EP 1982105491 A 19820623 (Local application)

Priority: US 1981286424 A 19810724

US 1981286425 A 19810724 US 1981286426 A 19810724

Designated States: (Regional Original) DE FR GB NL

Claim: The circuit has a monolithic substrate, having a number of 16-bit processors all accessing a common memory, busses including a status bus with synchronisation and arithmetic linkage lines. Each processor comprises a respective status bus multiplexer connected to the respective processor status bus. A bus control unit selectively connects the processor to the data bus or directly to a corresponding RAM memory module.

Each processor also contains interrupt manager which tests each successive interrupt signals to determine whether the respective processor which includes the interrupt manager is designated by the successive interrupt signal as an interrupter. The interrupt manager stores the priority of the one of the interrupt signals which initiated respective sequence of commands is currently being executed by the processor. The processors may be reconfigured programmably to operate independently in lock step or as pipelined processors. (28pp)

Japan

Publication No. JP 58058672 A (Update 198320 E)

Publication Date: 19830407

Language: JA

Priority: US 1981286426 A 19810724

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭58—58672

50Int. Cl.3 G 06 F 15/16

H 01 L 27/04

識別記号

庁内整理番号 6619-5B 7361-5B 7343-5B

8122-5F

43公開 昭和58年(1983)4月7日

発明の数 審査請求 未請求

(全 58 頁)

每再構成可能集積回路

13/00

15/06

昭57-128805

创特 20出

昭57(1982) 7 月23日

優先権主張 321981年7月24日33米国(US)

30286425

391981年7月24日39米国(US)

30286424

図1981年7月24日33米国(US)

30286426

個発 ロバート・エル・パドジンスキ

アメリカ合衆国テキサス州7508

1リチヤードソン・エツジウツ ド・ドライブ1106

勿発 サテイツシユ・エム・ザツト

> アメリカ合衆国テキサス州7508 1リチヤードソン・エルク・グ

ラーヴ1304

勿出 願 人 テキサス・インストルメンツ・

インコーポレーテッド

アメリカ合衆国テキサス州ダラ ス・ノース・セントラル・エク

スプレスウエイ13500

個代 理 人 弁理士 中村稔

外4名

1. 発明の名称 再構成可能集積回路 2. 特許請求の範囲

(1) 複数のプロセッサと、

上記のプロセンサの全てに各々が接続される 複数のパスと、

各々の上記プロセッサに接続されて上記プロ セッサの構成を選択的に変更してれによつて上 記プロセッサをロックステップでまたは独立に 作動可能とする手段。

を有するモノリシック基板を有する集積回路。

(2) 上記パスが複数の線を有する状況パスを有し、 上記状況ベスの上記線が同期線及び資算連結線 を有してむり、

各々の上記プロセッサが上記プロセッサの各 各及び上記状況パスに接続される状況パスマル チプレクサを有し、上記それぞれの状況パスマ ルチプレクサが選択的且つプログラムに沿つて 上記状況バスの選択された線に接続又は割込み を行い、さらに上記それぞれのプロセツサを選

択的に上記状況パスに接続し、これによつて上 記それぞれのプロセッサが上記状況パスを通し て上記プロセッサのうちの隣接するものに接続 されるようになつた特許請求の範囲第1項の集 费回路。

(3) 各々の上記プロセッサが上記それぞれのプロ センサに与えられる命令を受けとる為に接続さ れるダイナミック型論理配列(DLA)を有し、 上記DLAは:ANDマトリクス及びORマト リクスと、上配ANDマトリクスを上配ORマ トリクスに接続する中間線と:上記AND及び ORマトリクスの最初の1つと接続する複数の 入力線と:上記AND及びORマトリクスの他 の1つと接続される複数の出力線を含み、上記 DLAの上配AND及びORマトリクスの少く とも1つが行列に配列されて、それぞれの上記 マトリクス内の区画を規定するようになってお

上記区画は所望の論理機能を行うように配置 された選ばれた数の能動業子を含むように選択

的に配列されており:

さらに複数の制御線が設けられ、各々の上記制御線が選択的に1つ又は2つ以上の上記区画に存在する上記能動案子を作動させたり作動を切つたりする為に接続されることで上記 D L A が上記制御線の状況に応じて選択された論理機能を行うようになつており、

これによつて上記 D L A が制御線の状況に従って上記それぞれのプロセンサに選択的に与えられた命令を通訳するようになる、 特許請求の範囲第 1 項の集積回路。

(4) 複数のRAMメモリモシュールを持つRAMメモリが設けられ、前記パスは複数のおろに複数のパスを有し、さらに複数のパスを創し、さらに変数のパスを有し、さらに変数のパスを有し、がおいる各をは、からないというというというというというというというになった特許では、複数のRAMメモリモシュールに接続するようになった特許では、できない。

示されているかを判断し、上記割込み管理が上 記プロセッサによつて現在実行中のそれぞれの 命令シーケンスのいずれかを開始した上記割込 み信号のうちの1つの優先順位を記憶し、対応 するコンテクストスイッチ出力を与えてかり、

上記各々のプロセッサは上記割込み管理回路 の上記コンテクストスイッチ線に接続されるス ケアユラーを含み、

上記コンテクストスインチが新しく受取つた 割込み信号がより高い優先性レベルを有してい ることを示す時はいつでも上記スケデュラーが 上記対応するプロセンサによつて現在実行され る上記命令のシーケンスのとりかえを行うよう になつた、

特許請求の範囲第1項の集積回路。

(7) 上記パスは制御パスを含み、さらに上記制御パスに接続され外部ピンを有する外部割込み管理回路が設けられ、上記外部割込み管理回路は、上記対応する割込み信号のフォーマットを特定する長さに関する情報及び型に関する情報をそ

の範囲第1項の集積回路。

- (5) 各々のプロセッサの構造を変更する上記手段は、その作動によつて各々の上記プロセッサが同一の再構成可能集積回路上又は他の同様な再構成可能集積回路上の1つ又は2つ以上の上記プロセッサとロックステップ状態でまたはこれらから独立して選択的且つプログラムに沿つて作動可能である特許請求の範囲第1項の集積回路。
- (6) 上記パスが制御パスを有し、上記制御パスを有し、上記制御パスを有し、自身を転送する線及び割込み信号を転送するを含んでもり、各々の上記割込みを得ってつってがある。のシーケンスを開始すると、自動とでは、大記割込み管理の路が上記を引きます。上記をできまれた。というでは、大記割込み管理の路が上記をできまれた。というでは、大記割込みでは、大記割込みによって割込みにある。

れぞれ含む割込み信号を受信及び送信する為の 手段を有し上配長さの情報は、各々の割込み信 号の長さを特定するようになつた特許請求の範 囲第1項の集積回路。

(8) 上記ペスが複数の線を含む状況ペスを有し、 上記状況ペスの上記線が同期及びアース連結線 を有し、

上記プロセッサが上記それぞれのプロセッサの上記状況パスに接続されるそれぞれの状況パスマルチプレクサを有し、上記それぞれの状状のパスマルチプレクサが上記状況パスの選択的かつプロセッカンのではいる。 大説がスに選択的に上記がいる。 大説パスに選択的に接続しなればよって上記に 大説パスに選択的に接続しなればよって上記を れぞれのプロセッサを上記状況パスを通して上記 プロセッサに隣接するものに選択的且つプログ ラムに沿って接続し、

各々の上記プロセッサは、ダイナミック論理 配列(DLA)を持ち、上記DLAがANDマ トリクス、ORマトリクス、上記ANDマトリ クスをORマトリクスに接続する中間線とから なり、

上配AND及びORマトリクスのうちの第1のものに接続される複数の入力線と、

上記AND及びORマトリクスのうちの他のものに接続される複数の出力線とが設けられ、 上記DLAの上記AND及びORマトリクス の少くとも1つが行列に配列されて上記それぞ れのマトリクス内の区画を規定しており、

各々の上記区画が所望の論理機能を行わせる 為配置された選択された数の能動衆子を含むよ りに配列されており、

複数の制御線が、その各々が1つ又は2つ以上の上記区面に存在する上記能動素子を選択的に作動させたり又は作動を切つたりすることができるように接続され、上記 D L A が上記制御線の状況に応じて選択された論理機能を行うようになつており、

上記DLAが上記状況マルチプレクサに接続 され、これによつて上記それぞれの状況マルチ

数のパスとを有するモノリシック基板からなり、 上配複数のパスが複数の状況線を含み、

各々の上記プロセンサがデータパスハードウェアを有しさらにプログラム可能な論理配列(PLA)を有していて、上記複数のパスの上記状況線が上記PLAの入力及び出力、また上記PLAの上記出力及び入力線に接続されている集積回路。

プレクサから、上記それぞれのプロセッサに与 えられた入力及び出力が上記 D L A によつてプ ログラムに沿つて接続されるようになつた特許 請求の範囲第1項の集積回路。

(9) 複数のプロセッサと:

各々1つ又は2以上の上記プロセンサに接続された割込み管理回路とを有し、上記プロセンサの全てが上記割込み管理回路のそれぞれ1つに接続されており、

それぞれの上配外部割込み管理回路間で信号 を伝達するバス手段が設けられ、

上記各々の外部割込み管理回路は、それぞれ 長さに関する情報及び型に関する情報を含む割 込み信号の受信及び送信を行り手段を有し、各 各の上記型に関する情報が対応する割込み信号 のフォーマットを特定し、各々の上記長さに関 する情報が上記対応する割込み信号の長さを特 定している多重プロセッサンステム。

(1) 複数のプロセツサと、

各々が上記プロセッサの全てに接続される複

3.発明の詳細な説明

本発明はソフトウェアで変更が可能なプロセッサ間の接続を行う内部接続を持ち、共通メモリの全てにアクセスする多重ピットプロセッサを有し、様々な計算構成の改変も可能である再構成可能な I C に関する。

VLSI技術によつて得ることのできる経済的利点をいかす場合の主な問題点は、将来的な VLSI 部品で満足のゆくレベルまで価格を低減できるほど充分な量産が可能なものはわずかしかないとである。特に、応用例の多くの場合、プロセッサの機能にそれぞれ独自の構造を要求するので、各々の応用例に用いられるプロセッサはその目的に特に設計されることになり、必然的に高価格になる。

本発明の特に目的とすることは、1種の一般的 1 C チップの設計を用いて多数の種々の応用例に おけるプロセス上の要求を消たし、それに伴なつ て 1 C を非常に経済的に製造できるようにするこ とである。 主要プロセンサに加え I / O 機能制御(CRT デイスプレイのような)、メモリ管理、又は、特定の演算処理の為の専用プロセンサを使用するととは好都合である事が多い。しかしながら、上記で示した様に、個々の目的のために特別に設計された V L S I は高価であるので、このような専用プロセンサによつて得られる利益は十分には活かし得ていない。

本発明の他の目的は、特別製ではない一般的 ICを用いて特別な目的専用のプロセンサを容易 に構成する手段を提供することである。

とのような専用プロセンサを用いるにあたつては、これらを一般的な目的のプロセンサと共に単一チンプ上に集積すれば、特に好都合であることが多い。しかしながら、このような構造は更に特別な設計を必要とし、前述のように価格的な不必合の問題が生じることになる。

本発明の他の目的は、容易に量産可能な一般的な目的の再構成可能!Cを用いて、一般的な目的のプロセッサと1つ以上の特定目的のプロセッサ

そこで、本発明の他の目的は、ケートの高楽積を保持しながらカスタムメイドの楽積回路の必要を充たすことのできる集積回路を提供することである。

ゲートアレイは、非常に酸通性の高いしち」では というには、するでは、ないでき、ないできないできないできないできないできないできる。 がに行うことができる。しかしながら、ゲートアレイは、プログラム可能なシステムの補助にはあれば、ゲートアレイの集積度は通常プロセッサほど高くない。

したがつて、本発明の他の目的は、ゲートアレイより高いゲートの集積度を持ち、プログラム可能なシステムの補助に一層通した再構成可能集積 回路を提供することである。

比較的大規模で複雑なシステムを数学的にモアル股計したい場合、各々のプロセッサのアータ処理能力は比較的低くとも、高次の並列演算処理によつて全体的なアータ処理は非常に高くなるよう

とを単一チップ上に集積可能にすることである。

特定目的のために設計されたVLSIの他の問題点は、部品製造の歴史が長くなるほど完成部品の価格と歩留まりおよび信頼性が、「ラーニングカープ(智勲曲線)」に沿つて良くなるという傾向があるのに対し、カスタムメイドによる特定目的の設計では、価格や信頼性に顕著な改善が行われる程充分に長期の期間にわたり大量生産が行われることは通常はないということである。

したがつて、本発明の他の目的は、価格、歩留まりおよび信頼性がラーニングカーブに浴つて顕著に改善されるよう長期にわたり大量生産が可能な一般的目的を有する部品を提供することである。 カスタムメイドすなわち特定目的のために設計された V L S I は高につからになったのであるというで生産される部品をあるから、 クートの集積をが多い。 これは、少量で生産される部品をあるが、クートの集積を受けるとは、経済的でなくたの時間及び多くの費用を費すことは、経済的でなくたるという理由からである。

に大規模配列でプロセンサを使用することが望ま しい場合が多い。しかし、このような配列でプロ センサを使用することは、通常は特定の目的の為 のシステムとして構成されるので今のところ比較 的高価なものとならさるえない。

同様にして、非常に広い多重情密ワード(ここで複雑な軌道的システムが非常に長期にわたつてモアルされなくてはならない)を用いて長い連続する計算を実行することがしばしば望まれる。この場合に於ても、既製のシステムを適合させると、通常高価格又は低速となるか、又はこの両方の問題が生じることになる。

故に、本発明の他の目的は、特別なハードウェアを設計することなく、多数のこのような楽様回路を結合して、安価に配列処理及び/又は多重精密処理を行うようにプロセッサを楽機回路中に設けることである。

カスタムメイドVLS」のこの他の重大な問題 点は、ハードウエアの設計の変更及びテストが必 要とされるので設計のサイクルタイムがどうして も長くなることである。

そこで、本発明の他の目的は、単にソフトウエア及び/又はファームウェアを変化することによって特定の応用例にあわせて再構成可能を集積回路を提供することである。

多重処理システム、ダイナミック構造及びマイ クロプロセッサ構造の背景を一般的に理解する為 の参考文献としては以下のものがある。

のアプリケーション首語の函訳にも適合するVLSI プロセッサを経済的に与える手段を提供すること である。

多重プロセッサンステムの持つ多くの利点は、 めつたに有効に利用されていなり多重でいる。 は、単一プロセッサンステムとり多重でいる。 において、単したがいるでは、常に困難はは、 である。 の単一が、本発明の目的に構める の理可能ないステムの間を同単では、の の理可能ないかったがの のである。 のでないた。 のである。 のである。 のである。 のである。 のである。 のである。 のである。 のである。 のでないた。 のである。 のでる。 のである。 のである。 のでる。 ので。 のでる。 ので。 ので。 ので。 ので。 のでる。 ので。 ので。 のでる。 のでる。 のでる。 ので。 のでる。

多重処理システムの利用に関してのこの他の問題点は、ハードウェア構造に融通性がないという問題である。多重処理システムの動作の大部分は、ハードウェアの構造によつて決定されるので、また現在のところ提案されている全てのハードウェア構造はある型の問題に対し最適でも他には最適

「ダイナミック構造:その問題と解法」コンピュータマガシン78年7月26頁:カータシエフ&カータシエフ、「ダイナミック構造を持つ多重コンピュータンステム」28 IEEEトランズ 1979):カータシエフ&カータシエフ 「80年代の為のスーパーシステム」コンピュータマガシ、1980年11月号11頁:及びヴィンータマガシン1980年11月号17頁。これらは全てことに参照として示す。

使用者があまり知識を持たないような場合、特定の仕事にあわせた非常に高度なアプリケーション言語を設計することは、特に好都合である場合が多い。しかしながら、このようなアプリケーション言語がソフトウエアの形で実施される場合、速度が落ちることになるのが普通であるし、ハードウエアで実施されれば、通常、非常に高価なものとなる。

故に、本発明のとの他の目的は、あらゆる所望

ではないと思われるので、真に一般的な目的を果たすシステム(汎用システム)を実現する多重プロセッサハードウエア構造はまだ1つもできていないと思われる。

そこで、本発明の他の目的は、再構成可能であってこの為に真に汎用多重プロセンサハードウエ て構造となり得る多重プロセンサハードウエア構造を提供することである。

多くの多重プロセッサンステムに発生するこの 他の問題点としては、2つ以上のプロセッサがよ をプロセッサ間の干渉の問題である。いずれか1 つのプロセッサによつてアクセスできるようによ つの領域に拘束を与えることも可能であるが、 これによってプロセッサンステムによって受け れる一方、多重プロセッサンステムによって受け る大部分の利益を犠牲にすることになる。

したがつて、本発明の他の目的は、どのプロセンサもメモリのいずれの頑破にもアクセス可能でありながら、アータの完全性も保持できる多重プ

ロセッサシステムを提供することである。

マイクロプロセンサ言語と構造(アーキテクチャ)の間の、またマイクロコンピュータとミニコンピュータシステムの間のエミュレーションには、現在、比較的高額な費用がかかる。もしてきれば、ユレーションをもつと安価にすることができれば、より安価な開発及び試験が可能となり、たれば、より安価な開発及び試験が可能とステムによつて特定目的に設計された応用シスの使用範囲が広がり、新しい技術に一層早く適合できるようになる。

本発明の他の目的は、融通性があつて効率的な エミュレーションを行うことができる単一チップ プロセンサを提供することである。

故障のあつた場合をでも性能低下をおだやかに することができるマイクロプロセンサンステムを 提供することも認ましい。こうすることによつて、 ハードウエアに最初に生じた重要な誤動作は、チ ンプの機能に影響を与えなくなり、単にチンプの 機能をわずかに低下させるだけになるので、信頼

けとり循環させる I / O 通信機能及び外部プロセッサと接続するプロセッサ間の通信機能を選成するには、これらのためにハードウエアを別々に備えるとすれば非常に多くのハードウエアを必要とする。

本発明の他の目的は、 I / O 通信及び中間にあるプロセッサ間通信の両方を操作できる外部インタフェースを提供することである。

本発明の他の目的は、各々のプロセンサ内でプロセンサ間通信を管理する為また外部で発生した割込みを転送する為の両方に割込みを使用できるように作られた割込み管理構造を提供することである。

プロセンサンステムの動作機能又は構造を変更 する必要がある時に論理を再設計すると費用がか かり困難であるばかりでなく時間もかかる。

したがつて、本発明の他の目的は、論理を再設 計するのではなくプログラミングを変更する事に よつていかなるレベルにおいてもプロセッサのオ ペレーションを容易に変更できるようにすること 性及び歩留まりの両方が大巾に改善される。

本発明の他の目的は、ハードウェアに與りがあ つた場合、 壊骸的な誤りとするよりむしろおだや かな機能低下をおこすマイクロプロセンサシステ ムを提供することである。

非常に多数のプロセッサを持つ多重プロセッサンステムは、多重プロセッサが高価であること、これらの内部接続が困難であること及び大規模なンステム内のプロセッサ間のインタフェースの為に適当なプロトコールを特定することが非常に困難であること、などのために、今までのところその利点をわずかに利用できるのみである。

本発明の他の目的は、所要数のプロセッサを内 成している多重プロセッサシステムの中に容易に 組み込み得るプロセッサを提供することである。

I Cプロセンサを多重プロセッサシステムの中に組み込み得るようにする場合、さらに生する問題点は、外部プロセンサとのインターフェースの為にチップ上に別のハードウェアを準備する必要があることである。外部で発生された割込みを受

である。

プロセッサのハードウエアンステムにアーキテクチャコンパイラー (architecture compiler)を 提供できるようにすることは、非常に盈ましいと とである。このようなコンパイラは、プログラム のによって でいまから このようなコンパイラーを 補助する かしながらこのようなコンパイラーを 補助する たいは、 使能的 な内部接続の再構成を選択的且で アラムに沿って 実行できるハードウエアを 違える必要がある。

そこで、本発明の他の目的は、アーキテクチャコンパイラを使用する為に必要な機能の変更が可能な構造を持つプロセンサンステムを提供することである。

本発明は、単一チップ上に4つのマイクロプログラム可能な16ピットマイクロコンピュータを備えるものである。マイクロプログラミング機能は、個々のプロセッサを含む大規模PLAにより与えられるものである。各々のプロセッサは状況

(status) パス、データパス、及び制御パスと呼ぶるつの各々の主要パスに接続される。それぞれのプロセッサは、プログラム可能な内部接続として働く状況パスマルチアレクサをそれぞれ介し接続される。このようにして状況パス接続の種々の構成が可能となることで、プロセッサーとして)単独で作動させることも、(例えば1つの64ビットプロセッサー として)ロックステップ

(lockstep) で作動させることも、パイプラインで動作させることをもなったりに、カリースが得ったる。即ち、PLA翻訳によるマイクロが得られる。即ち、PLA翻訳によるマイクロが、プログラス接続を使用し、各々のプロセッサによるプロセッサ係成の融通性である。

プロセッサ制御に於てこの殷通性を利用する為、 各々のチップレベルの命令は、1つまたは2つ以 上の特定のプロセッサへと送られる。故に、プロ

用される。(1つの外部割込み管理及び2つの外部状況ポート及び2つの外部アータポートを合い外部インターフェース制御によつても、2個以上のRICチップ上のプロセッサを一緒に前に示したようを様々なモードで連結することが可能である。更に、外部インターフェース制御もまた外部メモリ、1/0装置その他へのアクセスを制御している。

どのプロセッサによってもアクセス可能な RAMを充分量チップ上に用意する。しかしながら、各々のプロセッサもまたチップ上のRAMの主要な区域に直接アクセスしている。全てのプロセッサは、RAM内のそのプロセッサ用の近先先のRAM内の区域にもアクセスする為にはプロのではからないというなアクセスを使用しなるらいは調整プックとステクセスを使用しないのである。ハンクアップ(nangup) 及び計手段が存在する。第1には256の世先段階が使用され、故に

セッサが(個々のプロセッサが同一のアータの流 れの中で次々と異るオペレーションを実行する)パ イプラインモードで動作することが望ましい時、 各々のプロセッサはそれぞれ命令を受け、パイプ ラインシーケンス内のその位置に適当なオペレー ションを実行する。ロックステップ処理の場合、 1つのプロセッサは、(シーケンスその他の制御 する)マスタープロセツサとして指定され、他の ロックステップ型プロセッサは全て同時に制御さ れる。これらの再構成の種々のモードもまた組合 せ得るので例えば、1つのチップは4つの独立な 16ピットプロセッサ、2つのペイプライン型 3 2 ピントプロセンサ、1つの 4 8 ピットプロセ ソサ(3つのロックステップ型16ピットプロセ ツサ)及び1つの独立16ピットプロセツサ等を 含むように再構成される。制御パスが複数の関連 のない命令シーケンスを運搬する為に区分され得 るので、単一の制御記憶管理を用い仲裁(arbitrate) され制御パスへの仲良が行われる多重割込み階級 組織 (multilevel interrupt hierarchy) が使

性の一致が起こらないようにする。第2に、全ての割込み(Interrupts)が並列に送られて、確認が行われる。第3に、実行を進める為に必要とされる資源を全部は手に入れることができなかつたプロセッサはいずれる、予め入手してあつた資源を全て放棄し、必要な資源が入手できるようになるまで待機する。

このような重要な構成要素に加えて、設計の仕様を完全に満たす為には多数の従来の部品も使用される。例えば各々のプロセッサは、ALU、ペレルシフター、メモリマッパー、マイクロシーケンサ等を有している。

本発明による利点は、前述した本発明の目的を全て解決するものであり、他の利点も当分野に通常の知識を有するものであれば明らかであると考える。例えば、構造の大部分(例えば全部で4つのプロセッサ)は同じものを複製して使えばよいので、ほとんど4のファクターでRICチップのハードウェアの配置を考える時間が低減される。もちろん、プロセッサは16ビットプロセッサ

である必要はなく、変わりに32ピット、8ピットその他であつてもよい。同様にして、チップ上のプロセッサの数は、4である必要はなく3でもまた5以上でもよい。実際は、最大のプロセッサ数は、製造技術によつて単に拘束されるのであって、より微細な加工が実用化すればたくさん非常に望ましいと予想される。このような場合ではよりである。このままでよい。もちろん、プロセッサが16ピット以外の場合には、それぞれのパスの規模は、それ相当に変化させならない。

本発明は、複数のプロセッサ、それぞれが上記プロセッサの全てに接続される複数のベス及び上記のプロセッサの各々に接続され、上記プロセッサを選択的に再構成することによつて、上記プロセッサがロックステップ又は独立して動作することを可能にする手段とを有する、モノリシック基板からなる再構成可能集積回路を提供するものである。

上記プロセンサは、上記それぞれのプロセンサに 与えられる命令を受けとる為に接続されるダイナ マック論理配列(DLA)を有し、上記DLAは、 ANDマトリクスと、ORマトリクスと、上記 ANDマトリタースを上記ORマトリクスに接続す る中間線と、AND及びORマトリクスの最初の 1 つに接続される複数の入力線と、上配AND及 ぴORマトリグスの他の1つに接続される複数の 出力観とを有し、上記DLA内の上記AND及び ORマトリクスの少くとも1つは、上記のそれぞ、 れのマトリクス内の区面を規定する為に行列で配 列され、各々の上記区画は所定数の能動衆子が含 まれるように選択的に配列され所望の論理機能が 行われるようになつており、さらに、複数の制御 線が設けられ、各々の上記制御線は、1つ又はそ れ以上の上記区画内に配置される上記能動衆子に 接続され選択的に作動可能にしたり作動不可能に したりして、上記DLAが、上記制御線の状況に 応じて選択された論理機能を行なりようにし、こ れによつて上記DLAは上記それぞれのプロセッ

また、本発明は、複数のプロセッサと、それぞれが全てのプロセッサに接続された複数のパスとを有するモノリシック基板からなり、前記パスは複数の線を持つ状況パスを含み、上記状況パスの上記線は、同期及び演算集合線(arithmetic

Tinkage lines)を含む複数のパスとを有し、各各の上記プロセッサは、それぞれの上記プロセッサは、それぞれの上記状況パスに接続される別々の状況パスマルチプレクサを有し、上記別々の状況パスマルチプレクサは、上記状況パスの選択された親といったのプログラムに沿って、これに選択的に接続しているというというというというというというというというというというというに選択的に接続するようになった再構成可能な集積回路を提供するものである。

さらに、本発明は、複数のプロセッサと、それ ぞれが全部の上記プロセッサに接続される複数の ベスを有するモノリッシク基板からなり、各々の

サに与えられた命令を上記制御線の状況に応じて 選択的に翻訳するように構成された再構成可能な 集積回路を提供するものである。

本発明はまた、複数のプロセッサと、それぞれ が上記プロセツサの全てに接続される複数のパス と、RAMメモリとを有するモノリシック基板か らなり、上配 R A M メモリは複数の R A M メモリ モジュールを有し、上記パスは複数の線を持つデ ータパスを有し、さらに複数のパス制御ユニット が設けられ、各々の上記パス制御ユニットは、上 記プロセンサの1つ、上記 R A M メモリモシュー ルの1つ、および上記データパスに接続され、上 記パス制御ユニットは選択的に上記プロセッサを 上記データペスに接続するか又は上記の対応する。 RAMメモリモジュールに直接接続するように友 つた再構成可能な集積回路を提供するものである。 本発明はまた、複数のプロセッサと、それぞれ が上記プロセッサの全てに接続される複数のバス とを有するモノリシック基板からなり、それぞれ

の上記プロセッサを再構成する手段が設けられ、

これによつて各々のプロセッサは同一の再構成可能集積回路上の1つ又は2つ以上の他のプロセッサといつしょにロックステップ形式で又は独立して、選択的且つプログラムに沿つて作動できるようになった再構成可能な集積回路を提供するものである。

それぞれのプロセッサが上記連続する割込み信号 によつて割合て先として指定されたか否かを決定 するようになつており、上記割込み管理回路は、 現在、上記プロセッサで実行される別々の命令シ ーケンスのいずれかを開始させた上記割込み信号 の1つの優先性を記憶し、上記割込み管理回路は、 各々の上記プロセッサにアドレスされた上記割込 み信号の各々連続する1つの優先性と、現在、上 記プロセッサで実行されている別々の命令シーケ ンスのいずれかを開始させた上記それぞれの割込 み信号の優先性を比較し、それに相当するコンテ クストスイッチ出力 (context switch output) を与えるようになつており、各々の上配別々のプ・ ロセッサは上記割込み管理回路の上記コンテクス トスイッチ級に接続されるスケデューラ(seheduler)を有し、上記 スケデューラは、上記コン テクストスイッチが新しく受取つた割込み信号が より高い優先レベルであると示す時にいつでも、 現在上配対応するプロセッサで実行されている上 記命令シーケンスの交換を行なりようになつた再

構成可能な集積回路を提供するものである。

以下、本発明に関し実施例を用い図を参照しながら詳細に説明する。

第1図は、再構成可能IC(以下はRICと略 す)のプロック図を示す。 P R O から P R 3 まで の4つのプロセッサは単一チップ上に形成されて おり、全てのプロセッサ間を接続する為、ろつの パス14、52及び56が設けられている。各々 のパスに対応して外部インターフェース76、 74と75、及び72と73が設けられ、またオ ンチップ R A M メモリ 6 6 及び制御記憶回路 3 8 (第2図)も形成される。より詳細な配置図は、 簱2図で示されている。第2図は、1つのプロセ ツサ P R 3 の全体と、それぞれの型の外部インタ ーフェースのうち1つ及び パス根とオンチップメ モリの一部を含む再構成可能ICの部分的フロア プランを示す。各々のプロセツサの割込み管理回 路12は、制御ペス14上に現われる割込みを常 化監視している。プロセッサ PR3 化アドレスさ れた割込みだけが、PR3内の割込み管理回路

12によつて認識される。とのような割込み信号 は P R 3 内のスケデューラ16によつて連続して 比較され、これらの信号の優先レベルがプロセツ サPR3で現在実行中の命令シーケンスの優先性 より高いかを調べる。これが高い場合であれば、 新しい割込みが導入した命令の流れ(このような 命令の流れは「プロセス」と呼ばれる)の実行の 開始が必要である。スケデューラ16は、対応す る出力を制御DLA22に与え、これはROM命 令レシスタ18又はRAM命令レシスタ20を作 動させるので制御DLA22が「プロセス」の中 に含まれる命令のシーケンスを受けとり始める。 制御DLA22は、以下に示すようにその構造上 の改良によつてパッキング集積度が非常に向上さ れている点を除けばPLAと同様に機能する。し たがつて、制御DLA22は、その内部のAND マトリクスにミンターム (minterms) を発生し、 次にORマトリクスがこれらのミンタームを次に 選択された論理和出力に変換する。制御DLA 22と隣接するのは、フィードパックプロック

24である。これを通つていくつかの制御DLA 220出力はフィードパックされ、DLA220 入力へと接続される。この意味で一定の状況によ る機械機能がDLA22に与えられるので、DLA 22は例えばある高レベルの命令を低レベルの命 令のシーケンスに翻訳することが可能である。 DLA22は、アコーダ区域25及び26に接続 され、これによつてDLA22の出力はALU メモリマッパー34等に対するハードウエア命令 として選択される。DLA22の出力は、またマ イクロシーケンサる6に接続され、これによつて 制御ペス14及び制御記憶回路3.8に対するアク セスの制御を行う。マイクロシーケンサ36は制 御パス14上に適当な信号を送ることが可能で制 御記憶アドレスレジスタ40を通つて制御記憶回 略38にアクセスしている。制御記憶回路38か ら呼び出されたデータは、制御記憶データレジス タ 4 2 を介し制御ペス 1 4 に出力され、更に、も レレジスタ18が割込み管理回路12によつて作

動されている場合には、ROM命令レジスタ18 内に入力され、制御DLA22のAND区域に対 する入力として接続される。メモリマンパー34、 レジスタフアイル32、パレルシフター30、 ALU28、シフトレジスタ44及びフラグレジ スタ46のオペレーションは、マイクロプロセッ サ技術としては既知の従来の主要オペレーション に従い行われる。

- ドが入つてくるタイミングでとに適当な状況パス の相互接続が行われる。

プロセツサPR3は、メモリマツパー34を介 してRAMメモリ66にアクセスしている。メモ リマツパー34からの額は、状況パス5.2を54 と交叉しており、什ス制御ユニット58でデータ パス56とインターフエースしている。パス制御 ユニット 5 8 は選択的にプログラムに沿つて作動 するので、メモリマッパー34からの出力は、プ ロセツサPR3が好ましくはアクセスするRAM メモリモシユール60に、アータレシスタ62及 びアドレスレジスタ64を通つて直接接続するか 又はデータパス.56を通つてチップ上又はチップ 外のメモリのどとか他の領域に接続される。RAM メモリ66の他の3つのモアユール(図示せず) のうちの1つにアクセスする必要がある場合、と のアクセスはデータパス56を介し、他の3つの メモリスケデユラーユニット68のりち適当な1 つと接続される。各々のメモリスケデューラユニ ット68は、先に来たものから先にサービスを行

う方法に従つてメモリアクセスの要求をスケデューリングし、制御レジスタ70を通つて相当するメモリモデュールへアクセスするよう制御する。 更に、データバス56は外部データポート72及び73(第1図参照)に接続され、これを通して各々のプロセンサは、チンプ外メモリにアクセス可能となつている。

同様にして、状況パス52及び54は、外部状況ポート74及び75に接続されるので、チップ外プロセッサは、多重チップ間のロックステップ及びパイプラインのオペレーションで同期するようになり、制御パス14が外部割込み管理回路76に接続されるので、チップ外プロセッサとの間で命令の送信受信を行うことができる。

制御配憶回路38は、それぞれの制御記憶モデュール制御器96によつて制御されるモデュール78に分割されている。RAMメモリ66も同様にしてモデュール60に分割されている。最後に複数のペッド接続領域80が外部との接続の為にチップ周辺に設けられている。また84ピンペッケージ

を使用することが好ましい。

前述した内容は、再構成可能集積回路の機能及び構造を示す概略的説明である。チップに関する さらに詳しい説明はいくつかの実施可能を応用例 としての提案を行いながらこれから説明する。

D L A を用いることが好ましいが、初期の開発段 階ではフィールドプログラム可能な(又は電気的 に変更可能でさえある) D L A を使用すると、需 要に対する融通性を拡げることができる。集積度 に関する厳格な最高の限界は所望のミンターム又 はマクスターム (minterm 又はmaxterm) の結果 にかかつているが典型的な P L A はトランシスタ 集積度の10%を有しているので、DLAの使用 により4倍の改良がミンタームを「折りたたむ」 ことによつて容易に可能となる。ダイナミック論 理配列 D L A は、領域をもつと有効に利用する為 に改良された P L A として簡単に考えることがで きる。そのかわりにDLAを回路レベルで再構成 可能にしたPLAとして考えることもできる。 DLAによつて多重機能をPLAで実施できるよ うになるが、一度に1つの機能しか利用できなく なるという拘束が与えられてしまう。 D L A は 2 から5倍の事で領域の有効利用が改善される。(マルチプレクサと共働する)DLAはまた単一の

量的に多い用途には、マスクプログラムによる

第3図に示すよりに、NMOS技術を用いてのPLAのNORゲート仕様においては、ORマトリクス内にゲートを形成するトランジスタと共にANDマトリクス内にゲートを作るトランジスタは、共通して接地されるソースを全て有している。特定の機能を作りだすトランジスタのソースがフロートされている場合、回路は、これらのトラン

ソスタが取り除かれたかのように働くのでその機 能は働かなくなる。NORゲートDLAの背景に ある基本的思想は、機能を行り為の全てのトラン シスタを制御額に接続し、機能を働かせる時に制 御線は接地され、機能を働かせない時にフロート にするということである。DLAで多重機能を作 りだす為には、各々の機能を作りだすトランジス タのソースを、その機能に対応する別々の制御線 に接続する。第3図は、典型的なNORゲート D L A を示している。通常の P L A 回路は、実線 で示され、DLAを作る為の追加的回路は、点線 で示されている。DLAは破線によつて示されて 区分されている。種々の区分は、PlからR8ま での表示が付されている。制御線C1が論理1で ある場合、区分P1及びP5に於る回路が作動さ れ、出力 E 及び F は、入力 A 、 B 及び B の 関数と たる。制御線C1がBレベルである場合、E及び Fの出力は、いずれの入力の関数としても制御さ れることもない。追加の回路もまた出力E及びF を入力A、B及びBの関数として制御される他の

機能を作り出す為にP3及びP7の区域に追加することができる。

同様にして、第3図の制御線C2は区分P4及びP8に於る回路を作動又は非作動状態にすることができ、追加の出力機能を与える追加の回路を区分P2及びP6内に追加することができる。

この回路は、あらゆる数の区分に対しても一般 化することが可能であつて、この区分は様々なサイズが可能である。またANDマトリクスは、 ORマトリクスからは分離して制御可能である。

第3図は、スタテインクケートPLAに基づいて改良が行われたDLAを示しているが、明らかなように、上配の説明はダイナミンクケートPLAに基づくDLAにも応用することはできる。ダイナミンクケートDLAを作る為に必要を追加の問辺制回路は、特にPLAが大規模である場合でも非常にわずかなチンプ領域を増加するだけで足りる。

第4図はNANDゲートDLAを示す。多重化された機能の選択された1つを作り出す為にPLA

翻訳の為にDLAを使用することによつて、各各のプロセンサの翻訳システムは、DLAのオペレーションのモードを選択することによつて容易に再構成可能となる。より高価であるフィールドプログラム可能構造も使用者の開発にとり有用で

あるが、D L A 2 2 はマスクプログラムによるものを使用することが好ましい。

とのよりに、制御DLA22を使用することで、各々のプロセッサ内で必要とされる複雑なマイクロプログラミング機能を得ることができる。マクロ命令を入力としてDLAに与えているペスについて以下に説明する。

DLA22は、また単にリアルタイム入力を DLAの入力線の1つに接続し、その入力とDLA の適当な出力をAND接続することによつてリア ルタイム機能を提供する為に使用されている。

制御記憶回路及び制御バスの構造及び使用する 割込み制御システムにつき以下説明する。

ある実施例に於ては、中央制御記憶回路は、4 つの全てのプロセッサにアクセス可能で共用が可 能である。ととで示す好ましい選択例では、制御 記憶回路38のどの部分にも各々のプロセッサが アクセス可能なままにしておきながら、プロセッ サの中の制御記憶回路38は、プロセッサの中の データ記憶部と同様の配置で、配置されている。

4つのマイクロシーケンサ36は、並列アクセス が可能でないが、単に低い平均アクセスタイムは 可能である。もちろん、マイクロシーケンサ36 は(ベス制御ユニット38と同様に)並列アクセ スが可能なようにも構成されるが、これにみあり だけの利点は得られずに、追加の回路によつて複 雑性は増すことになる。中央共有可能制御回路は、 以下のような利点を与えている。多重プロセッサ で使用されるコードは複製されないので、メモリ 領域をより有効に利用することができる。各々の プロセツサに与えられる制御記憶量を要求に対し て、より良い具合に合わせることが可能になる。 メモリを中央に集中できるのでフィールドプログ ラミングが実用的である。もちろん、中央制御記 憶回路にアクセスする単一のチャンネルがシステ ムの障害となるのを避ける為に、制御記憶回路に 記憶される命令のレベルを充分に高くして、各々 のプロセンサが制御配憶回路から受けとつた各々 の単一命令を、実行する為に平均して4又はそれ 以上の完全クロックサイクルを要するようにした

くてはならない。現在のマイクロプロセンサのソフトウェア構造に於ては、1つのアンセンプリ言語命令には典型的に平均して5ないし10サイクルを要するので、命令のレベルに関する上記の拘束は、容易に満たされる。

マイクロシーケンサ36は、ROMメモリ内に 記憶はついてからからな実行するシーケンの命令を実行するシーケンとなったかった。シーケンカる。クロンスとのがあった。クロックのでは14ピットののは、15ピットののは、15ピットののでは、15ピットののでは、15ピットののでは、15ピットののでは、15ピットのでは、 図に示すにとどめる。

中央制御記憶回路構造は、中央共有制御バスを含んでいる。中央制御パス14は4つのプロセンサトR 0から P R 3 の中の制御記憶回路 3 8 の使用の仲裁を行い、プロセンサからのマイクロ命令を複数のマイクロを送している。制御パス14は、チンプの長さと同じ位の長さで設けられた7 3 を初している。故に、バスは高価な資源するとで設まして、別に使用できるように制御パスの帯域をフルに使用できるように制御パスの帯域をフルに使用できるように制御パスの帯域をフルに使用できるように制御パスの帯域をフルに使用できるように対象がプロセンサのマイクロ記憶 アクセス率とほぼ一致する。

本実施例に従つた制御パス14の構造が第5図 化示される。制御パス14は制御アータパス82. アアレスパス84、割あてパス(destination bus) 8 6 、割込みパス8 8 及びデータルーチン パス80を有している。制御アータパス82は、 制御記憶回路38からとつてきたマイクロ命令を プロセッサPROからPR3までに転送している。 とのパスは40本分の線の広さである。アドレス **パス84は、マイクロシーケンサ36によつてそ** れぞれのプロセッサ内で発生されたアドレスを創 御記憶回路38に送り、マイクロ命令をとりだし ている。以下に説明するように、アとレスパス 84もまた割込み期間中は優先性の情報を運んで いる。とのパスは14本分の線の広さであつて、 制御記憶回路38に16Kワードのアドレス領域 を確保している。割合てパス86はプロセンサが 制御記憶回路38にアクセスする時にいつでも使 用され、1つまたそれ以上のプロセツサPRo-PR3及び外部割込み管理回路76のいずれかで 現在アクセスされている制御記憶回路38内のア

ドレスに記憶されるアータを受けとるかを知らせ る。割合てパス86は、割込み期間中に使用され プロセッサ P R ₀ — P R 3 及び割込み管理 7 6 の うちのいすれが現在の割込みを受け取るか(即ち 割込み先 Interruptee)を確定している。割当て パス86は線5本分の広さである。割込みパス 88は割込みのソースを転送するのに使用される。 このパスは、割込み先プロセッサに対し割込みが 手元にある中で最も高い優先性のタスクであるか どうかを知らせる為にも(即ち割込み先プロセン サが割込みを受入れるかを知らせる為に)使用さ れる。との型の応答では、パイプライン型又はロ ックステップ型オペレーションを必要としてプロ セスを迅速に設定(又は延期)する必要がある。 割込みパス88は5本分の線の広さである。ゲー タルーチンパス90は制御記憶回路92によつて 制御され、PROからPR3のうちの1つ又は2 つ以上のどのプロセツサが現在制御パス82で転 送中のマイクロ命令を受けとるのを示す為に使用 される。アータルーチンパス90は5本分の線の

広さである。線DRO-DR3は、ROMからとり出されたワードの割当て通りに又は割込みに応じてPROからPR3のりちの対応するプロセッサを指定する為に使用される。線DR4はROMからとり出されたワードの割当て又は割込みに応じて外部割込み管理回路を指定するために使用される。

最後に、制御パス14は、花輪状に連結する、割込み準備線104も有している。花輪のように連結することによつて割込みを送ろうとしているプロセッサ間でラウンドロピン型の仲裁を行つている。プロセッサが制御パス14を支配して、た

によつて実行され、残る機能は、適当なモデュール制御回路 9 6 によつて実行される。モデュール制御 9 6 はここで要求されたアクセスの為のアドレス及び割当て先を待ち行列にしてFIFOのオーダーで要求された制御ワードを読み出す。

制御パス14による仲数は、プロセッサPROからPR3の間を花輪状に結ぶパス作動線98(第5回参照)を用いて行われる。あるプロセッサが制御パス14を支配するとき、このプロセッサはフルの1サイクルのみの間制御パスを使び速れているの第1フコイズ、及びエイズの間、パス14を制御するのではないがデータを受けたのプロセンは、連続はないないであるので、パス14を制御するにしているのではないないであるので、パスに動きのではないないでは、連続は1つのプロセッサは制御メモリへを持つなの連結のにはないないを

だちに割込みを発生する時、プロセンサは、花輪 状に連結する割込み準備線104にゼロまで引き 下げる信号を送る。割込みを送るプロセンサは制 御アドレスパス84を支配する前に割込みパス 88を引き継ぐことができる。割込み元プロセン サ(Interrupting processor)が割当てパス。 86を支配する時、発生した割込みの割当てパス。 ある外部割凸なみ管理回路76上のプロセンサに、割 込みを発生した後、発生元のプロセンサは、自分 が割込みの発生元であることを割込みパス88上 に示し知らせる。

割込みが開始された後、他の割込みは少くとも2パスサイクルの間禁止される。1サイクルは割込みを送る為で1サイクルは、受け取り個プロセッサ(割込み先 Interruptor)が受けと元プロセッサ(割込み元 Interruptor)が受けとる為である。割込みをパッフアすることだけが必要な場合、割込み先の割込み管理回路は割込みのプロセスは可能で1から4の追加パスサイクルが

過ぎるまで他の割込みを受けとる用意ができてい る。割込みの受け取り個がロックステップ又はペ イプラインモードで連結するよりになつた場合、 即ちコンテクストスイツチが必要とされる場合、 割込みパス88は、必要なコンテクストスイツチ を実行する為に使われるタイミングの間プロック される。コンテクストスイツチの長さは、割込ま れたプロセツサ内にどれほどのコンテクストが(即ちレンスメの内容、ALU状況等)保持されて いるかに左右される。以下で説明する通り、いく つかのコンテクストスインチはプロセッサのコン . テクストを本質的に完全に変更することが必要で ある一方、他のスイッチは最小の変更のみを要す る。最も短いコンテクストスイツチでも通常3又 はそれ以上のパスサイクルを必要とする。との選 延が割込み信号の帯域幅を限定するが、割こみが フルに有効な帯域幅を占めるとは予想されないの でとの方法は適していると思える。この遅延は長 い実行を通しての割込み信号の選行の平均したレ ートを落とさずに突然の割込みの発生をスムーズ

にする目的を果たしている。

割込みは、それぞれの命令のシーケンス(即ち 各々の「プロセス」)を開始する為に使用される。 上記で示した様に、割込みは優先レベルを特定し、 アータルーチンパス90内を移動しどのプロセツ サがアドレスされるかを特定する4ピツトコード を有している。もし割込みによつてアドレスされ る全てのプロセッサが有効な状態にあるならば、 (即ち、とれより高い優先性のタスクは手元にな い場合)プロセス内の命令シーケンスの実行が開 始される。もし、実行すべき命令が制御記憶回路 38に存在している場合、この命令は適当なマイ クロシーケンサ36によつて次々と就出される。 実行すべき命令がRAMメモリ66内にある場合、 この命令は、適当なメモリスケアユーラユニット 6 8 及び パス 制御 ユニット 5 8 化 よつて R A M メ モリから次々と読出される。各々の影響をうける プロセッサ内のメモリマッパー34はこれらの命 **令をRAM合合レジスタ20を通しDLA22に** 転送する。DLA22はこれらのRAM命令を

ROMアドレスにする翻訳を行つていて更にこれ 60R0Mアドレスはマイクロシーケンサを介し てアクセスされている。また、RAM命令は、 DLA22によつて直接アコードすることができ る。ROM内に記憶される制御ワードはプロセツ サ仕様フィールドを有していない。しかし、制御 ワードは、唯一固定された定型部分がオプコード (op code)である短いピットのストリング(好 ましくはる2ピット)である。ROMから呼びだ された制御ワードがプロセッサのDLA22に回 帰され、制御ワードと共にRAMから受取つた命 今によつて特定されるあらゆる定数及びオペラン PがD L A 2 2 によつて通訳される。 D L A は、 OPコードと同時に例えばオペランドフィールド、 定数フィールド、マイクロシーケンサ命令、メモ リインターフェース命令、状況パス命令、(命令 が割込みである場合の)割合て及び優先性データ、 割込み管理回路の制御の為の命令、スケデューラ、 パレルシフタ等であるオプコード及び制御ワード 化従つて残りの制御ワードフィールドを通訳する。 命令ワードの適当な部分が更にアコードされ、ア コーダ25及び26に制御されるDLAによつて 適当なハードウエアに直接接続される。

もちろん、とのマイクロプログラミング通訳構 造では、ハードウェアでの実行以前にこれ以上の ステージを持つ通訳機構を用いることも可能であ る。例えば、制御記憶回路38から読出された命 令は通訳され、制御記憶回路 3 8 又は R A M 6 6 から読みだされた他の連続する命令の実行を要求 するようにたる。更に、チップ外メモリも命令の 実行に使用される。例えば、アプリケーション督 **語から成る単一命令が非常に長々しいアプルーチ** ンを示している場合、制御配憶回路38内の相当 する制御ワードは、通訳されて、RAMメモリ 66の特定プロックにあるサブルーチンをロード し、引き続きそのサブルーチンの命令を実行せよ という命令が出る。もちろん、チップ外の記憶容 量に記憶される命令はとりだされ以下にさらに詳 しくのべるように割込み管理回路76及び/又は 外部アータポート72及び73を通つて実行され

a .

割込みプロトコールに関するこれ以上の説明は 以下で示す。以下で示すRICを異るモードのオペレーションに変更する再構成機構は制御パスのオペレーションに関連づけて説明する。この点に 於て、プロセッサPROーPR3の各々の構造に ついてもざらに詳しく説明する。

第2図からわかる通り、各々のプロセンサは、
DLA22及び共働アコーダ25及び26に加え
て、フィードバック線24及び命令レジスタ18
及び20、割込み管理回路12、メケアンレジスタ
ファイル32、パレル(barrel) ンファク
ファイル32、パレル(barrel) ンファク
スタ46を有している。後半の構成部はに詳細に
説明する。例えば、第9回は、ALU28及び110
は、プロセンサ内の他のプロック例えばパレルシ
フタ30からの入力として提供されている。この

供している。(DLA22内の)フラグ発生論理 134は、フラグレジスタ46に接続され、出力 ラッチ136はシフトレジスタ44に接続される。 次にシフトレジスタ44はパスA及びB(108 及び110)を通つてレジスタフアイル32に接 続されるか又はメモリマンパー32を通してパス 制御ユニット58に接続されるので、ALUの出 力は、データパス56内を転送されるか又は、将 来のオペレーションで使用する為にプロセッサ内 に配像される。

第10 図は、A L U 28内の機能プロック116、 118又は122の1つの一部分の部品レベルの 構造を示す。第11図は、A L U 28内の桁上げ 連鎖プロック120の一部分の構造を示す。マイ クロプロセッサの構造に関するこれ以上の参考は 例えばオズボーンアンドアソシェートに示され、 これは参考としてことにいつしょに示す。

第 1 2 図は、データイスの概略 図である。 入力 信号は、イス 1 0 8 及び 1 1 0 から入力され、 これらのパスにはそれぞれ入力ランチ 1 3 0 及び

パスはそれぞれの入力ラッチ112及び114を 介して、P(伝播)機能プロック116、K(適 断)機能プロック118 、C(桁上げ連鎖)プ ロック120及びR(結果)機能プロック122 に連続して接続される。伝播機能プロック116 は、P制御線124によつて制御され、遮断プロ ツク(kiil block) はK制御線126によつて 制御され、結果プロックはR制御線128によつ て制御される。これらの制御額はDLA22から A LU28までを接続している。更に、桁上け入 力(carry in) 粮130及び桁上げ出力(carry out) 線132が提供されていて、C プロック 120を状況マルチプレクサ48及び50に接続 する。(状況マルチプレクサ 4 8 及び 5 0 のオペ レーションは、状況パスプロトコールに関連して 以下でさらに詳しく説明する。) R プロック122 の出力はデュアルバスであつて、フラグ発生論理 134を通つて出力ラッチ136に接続されてい る。フラグ発生論理134は状況とエラーの情報 を計算しDLAを介しプログラム状況ワードを提

140が接続されている。とれらのラッチはパレ ルシフタ30の入力と接続する。 パレルシフォ 3 0 は、制御線1 4 4 及びパラメータ入力1 4 6 によつて制御されている。とれらはまた両方とも D L A 2 2から提供されている。パラメータ入力 146は、例えばシフトカウントの為、及び抽出 の限界(extraction boundaries)の為の値を与 えている。パレルシフタ30はパスA及びパスB に出力を与えている。 A L U は、桁上げ、オーパ ーフロー、負数及び/又はゼロといつたよりた演 算状況信号を発生している。 A L U は、整数のオ ーパーフロー、十進数の桁上げ等といつたこの他 の割とみ信号も発生している。とのような信号は、 D L A に送られて D L A は、これらの信号に従っ て論理オペレーションを実行し信号を発生してい る。この信号は、フラグレジスタ内でピットをセ ットする。との機構によつて状況セット信号を発 生させ、例えばコンピュータ構造の中を循環させ

第13図は、パレルシフタ30によつて形成さ

れるシフトオペレーションで使用する用語を示示している。従来、左シフトは、最上位ピットに向かるとを示す為に使用される。即は左シフトは左シフトに関しては、左関ファ位に、左関ア位になったでは、左関ピットであつて右シフトでは、シフトはペレーションのとの他のといったで、第148図は、砂を左シフトを示している。第148図は、いる。

第 1 4 b 図は左循環オペレーションを示しており、入力ラッチ A 1 3 8 の最上位ピットは、入力ラッチ B 0 最下位ピットにマッピングされ、入力ラッチ B 1 4 0 の最上位ピットは入力ラッチ B 1 4 0 の最上位ピットはつてからない。他のピットはそれに従つてシフトされている。第 1 4 b 図は、1 ピットの循環オペレーションは、パレルシフタ内の1 クロッタサイクル期間中に 1 6 ピットまで右又

は左に動きりる。

第14c図は、シフト及び連結オペレーションを示しており、ここで入力ラッチ138は右にシフトし、連結入力線(IInk-in line)152が最後尾ピットの新しい内容を与えている。先頭ピットの内容は、連結出力線(IInk-out line)154を通り出力される。本実施例に於て、連結スカカ152及び連結出力線154は、入力ラット8140から接続されているので多重ピットシフト及び連結のオペレーションが実行されるに用いる連結入力及び連結出力線を代わるがわるに用いることもできる。

第 1 5 図は、パレルシフタ 3 0 によつて実行される抽出(extraction) オペレーションを示している。 ここに示すオペレーションでは、 パレルシフタ 3 0 は命令を受けて入力の 3 ー 1 1 ピットを抽出している。 これらのピットは出力ラッチ 1 5 0 に先頭ピットとして接続される。 このような機能をパレルシフター 3 0 に実行させる為に必要とされる回路は既知のように例えば先に参照と

して示したミード及びコンウエイの「VISIシステム入門」に示されている。

メモリマツパー34はプロセツサ構造としては よく知られる機能を形成する単なるありふれた構 造である。メモリマツパー34によつて受けとら れる仮想的(ヴァーチャル)アドレスは共働する メモリオペレーションによつて16の記憶されい た仮想アドレスと並列に比較が行われ、もし受取 つた仮想的アドレスが記憶されていた仮想的アド レスの一つと整合する場合、これに相当する地域 的アドレスが使用され所望のワードが地域メモリ ーから呼び出される。整合するものがない場合、 仮想的アドレスは(ページテープル索引のような) テーブル索引によつて翻訳され実際のアドレスを 決定し、レジスタファイルの1つに随意にロード 可能となる。との意味で、メモリマツパー34は 内部的に記憶されるメモリュニットと外部的に記っ 偉されるメモリユニットを区別しているといえる。 故にメモリマツパー34はテープル検索をとま切 れにする (hashing) ととができるように構成さ

れ、ハツシュテーブル内の位置を選択する為に使 用されたハッシュ機能はファームゥエアによるプ ログラムが可能 である。ハツシユテープルはマル チウェイセット共働メモリとして作られている。 ハッシュ機能の出力は並行して検索が行われる多 重位置を指示する。 所望のアドレスがハッシュテ ープルで多重位置に於て行われた比較と整合しな い場合所望のアドレスは(設計上)テープルに存 在しないということなのでこれ以上の検索は必要 たくなる。故にこのマッピング機能は様々なサイ ズのメモリのマッピンクを行う。ハッシュ機能が 記憶容量を補助する為に使用される場合、ハッシ ユテープルエントリーが数10パイトのメモリユ ニットを指示する。ハッシュ機能が仮想的メモリ 翻訳ルツクアサイドペッファを補助する場合、メ モリユニットは典型的に 5 1 2 パイトから2,048 パイトまでにたる。メモリマッパーに適当な構造 をもつ物としては、ナショナルセミコンメクタ社 のチップ番号16082がある。

割込み管理回路12は制御パス14を通つて転

スケデューラ16は256ピットンフトレジスク内の優先性によつて割込みをパッファナる。プロセヌが有効に行われている時、スケデューラ16はシファウェスを見つける。現在のプロセスが完了又は時間切れの場合、スケデューラ16は次に高い優先性のプロセスのロテクストを示す。適当なコンテ

スタック/レジスタフアイル32は、2本のパス108及び110を十分に利用できるようにする為にアニアルポートのレジスタフアイルでなくてはならない。さもなければレジスタフアイル 32は従来と全く同じである。

アータパス 5 6 の組織は、R A M メモリ 6 6、パス制御ユニット 5 8 及びメモリスケデューラユニット 6 8 のオペレーション及び構造といつしよん以下で説明する。

第16図は、データパス56の構造を示している。アータパス56は16本のアドレス線156、16本のアータ線158、ラウンドロピン仲裁線160、4本のソース線162、モデュールピー中線167を有している。別々のアドレス線156及びアータ線158によつてアータアクセスのオペレーションが単一パスサイクルで実行で明能となっている。この場合チップ上のRAMメモリ66がアクセスされるので少くともメモリアクセスにはこれを可能にしている。こうする代わりに、

クストは、スタック/レジスタフアイル 3 2 から、 R A M メモリ 6 6 から 又は外 部メモリから再び呼 び出される。

第18図は、上記で示したアータペスの総体的 た全体図を示す。 ペス A 及び B (1 0 8 及び 110) は、主要を構成部であるデータパス、即ちスタツ ク/レジスタブアイル32、ペレルシフタ30、 A LU 2 8 及びフラグ及びシフトレジスタセット 4.4及び4.6の側面に設けられる。更に左側ポー ト170はテータパスの入力及び出力の末端に設 けられている。好ましい実施例ではないが、右側 ポートを用意する選択も可能である。このあるプ ロセッサの右ポートは、隣接するプロセッサの左 ポートに接続する為に使用される。例えば、プロ セッサPR3の右側ポートは、プロセッサPR2 の左側ポートに接続される。リテラルレジスタ 174もまた定数を発生させる為に提供される。 入力はメモリマツパー34から接続する左ポード 170に接続され、右側ポート172からの出力 **もメモリマツパー34を通つて接続される。**

アドレス線及びデータ線156及び158を多重 構造にし領域を節約することができる。ラウンド ロピン仲裁額160は4つのプロセッザPR0-PR3、4つのメモリモデユール60、及び外部 アータポート72及び73の間を花輪のような形 で連結しているので、データパス56へのアクセ スは有効に仲穀が行われる。4本のソース線162 は、現在転送中のメモリアクセス要求のソースで あるプロセツサ又はモアユール又はアータポート を特定している。その代わりに制御線164の状 況に従つて、ソース線163を使つて、どのメモ リモアユール60がメモリモアユールによつて久 にサービスを受けるのかを示している。10本の 割あて銀168は、どのプロセツサ、モアユール 又はポートがデータを受けるかを示す。ソース状 況線166は(もし低論理であれば)ソース線 162は更にプロセンサ、モアユール又はアーク ポートのどのメモリの要求が次にサービスを受け るのかを示す。ソース状況線166が高電位状態 にあるということは、ソース線が現在のソースを 示しているととを要わしている。また、メモリの 読み出しに使用されるか又はメモリの書込みに使 用される為パスが停止状況(idie) にあること を示す2本のパス状況線165も提供されている。

第17図の流れ図はさらにデータパス56内の 糠の利用をさらに明らかにしている。一度、いず れかのソース(プロセッサPR O - PR 3、RAM メモリモデユール60、又はテータポート72又 は13)がデータパスへのアクセスを受けとると (即ち、一度、 そのソース が 花輪 状連結 線 160 から高電位信号を受けとると)ソースは譲162 上に4ピットロードを示す。ソースがRAMメモ リモアユール60であつて、対応するメモリスケ テューラユット 6 8 が未解決のメモリ 要求を有し ている場合、ソース級162はぞのプロセッサ又 はメモリモアユールが次にサービスを受けるかを 示すようになり、終166は電位が引き上げられ る。との後で、また未解決のメモリ要求を持つメ モリモアユールがソースでない場合でも、メモリ アクセス割当て粮168の電位が引き上げられて 脱出されるべきテータに関する 1 0 個の割当てから成るいずれかの組合せを示す。連動回路(Interlock)は、データの完全性を保つ為に提供されている。もし割当て先に未解決のメモリ要を持つメモリモデュール 6 0 を 1 つまたは 2 つ以上が含まれる場合、ワイヤー A N D E D 線であるピソー線 1 6 4 の電位が引き上げられ、同一のメモリスペースに対し同時に読みこみ及び書込みが行われることがないようにしている。

第19図は、RIC内のRAMシステムの組織を総体的に示す概略図である。各々のプロセツサPR3は、メモリマツパー34を介して、アータパス56へのインターフェースとして働くパス制御ユニットBCU58に接続される。各々のBCU58は対応するメモリスケアユーラユニットM3U68の各々は両方とも対応するRAMメモリモアエール60に接続される。

プロセッサが自分のメモリモアユール 6 0 KT クセスする時、プロセッサは自分の B C U 5 8 を

通つて自分のMSU68に姿貌される。MSU 68は未解決のメモリ要求があるか否かを決定す る。未解決のメモリ要求が存在しない場合、アク セスがただちに発生する。アクセスが決定されて いたい場合、MSU68はメモリのサービスを最 初に要求したかを示すタグ(tag)を待ち行列に する。MSU68は先に来たものから先にサービ スを行うスケデュール方針に従つて要求を待ち行 列にする。特定の要求が列の先頭まで達した時 M S U 6 8 がとのととをプロセツサ又はアータボ ートに信号で知らせる。このプロセツサ又はデー タポートは再び要求を発生し、メモリアクセスが ただちに行われる。プロセッサがそのプロセッサ 以外のメモリモアユールにアクセスする時、パス 制御ユニット58はアータパス56を介して適信 が可能になるよう構成されなくてはならない。故 化例えばプロセツサPRBがプロセツサPR1に 相当するメモリモアユール60Kアクモスする場 合、PR3に対応するペス制御ユニツト58は、 プロセッサPR3をアータパス56に接続するよ

りに構成され、PR2に対応するBCU5 Bは、 信号をアータパス56によつて転送できるように 構成され、プロセッサPR1に対応するBCU 5 8 は(プロセッサPR3に向かり方向で)テー タパス 5 6をプロセツサPR1に対応するRAM メモリモアユール60亿接続するより構成された くてはならない。上記のように、プロセツサはま ナラウンドロピンのオーターでスケソユールされ た共有のアータパス56にアクセスできるまで待 機している。プロセツサはパスにアクセスした後 で、プロセッサはメモリ情報及び割当て先メモリ モアユールを示す朝当てタクを連送する。各々の プロセッサ又はアータポートは、一度に1つだけ 未解決のメモリ要求を持つことができるので、ど のメモリモデユールも最大でもつまで未解決の要 水を持つことができる。各々のプロセッサのメモ リインターフェースは、アータイス56を通つて 送られてくるメモリ制御信号を鑑視する回路を有 している。この機能はメモリマンパー34によつ て実行される。

R I C の内部 R A M メモリは、好ましくは最小の数細加工特徴が1ミクロン(ラムダ=0・5ミクロン)である(パスドライパーのような C M O S 技術を実現する高出力構成案子を用いた) N M O S R I C の中に作られた16 K パイトのダイナミック R A M である。

パスの両方に接続され、パイディレクショナルス イッチはある位置で単にメモリマッパ34をレジ スタ62及び64に直接接続するサービスを行つ ているので各々のプロセンサはそれに対応するメ モリモアユール60亿並列にアクセスすることが できる。他の位置のパイテイレクショナルスイツ チ 1 7 8 は、 M S U 6 8 を (短いパス 1 8 6 を介 し) テータパス56 に接続するサービスを行つて いる。同様に、スイッチ182は、(対応するプ ロセッサがその対応するメモリモアユールにアク セスしている時)アータの流れをプロックするか 又は、単に短いパス184をアータパス156に 直接接続するか又は、短いパス184をパイデイ レクショナルスイッチ180が封錯モードである 時に絶縁されている2つのデータパス56の組に 方向を指定して接続するか、これらのいずれかを 行つている。とのオペレーションモードは第21 図に示されていて、パイプラインモードでのRIC のオペレーションが可能にしてある。この場合、 各々のプロセッサはオペレーションの前段階から

アータを受けとり、同時にオペレーションの次に続く政階にアータ出力の流れを与える。故に、パイプラインモードは、隣接するプロセッサの個別な組の間を異るアータの流れを並列に転送させてゆくことを必要とし、この機能は、パイアイレクショナルスイッチ180をプロックモードにすることによつてまたペイアイレクショナルスイッチ182を方向を指定して接続することによつて実現される。

メパス56内のBCUモード制御根167によつ て行われる。いずれかのプロセッサがテータパス を制御する時、そのプロセッサは更にBCUモー ド級167を使つて全てのBCUを制御すること ができる。仲裁額160がプロセッサがデータハ ス56を制御していることを示す時、全てのBCU 58に於て満たさなくてはならない、唯一の必要 条件は、パイテイレクショナルスイッチ180が アータパス5.6をプロックしていないということ。 である。更に、各々のBCU58内のパイティレ クショナルスイツチ178は、テータペス58を レジスタ62及び64に接続するように作動して いる。故に各々のアドレスレンスタ64は、要求 されたアドレスを受取り更に適当なMSU68が、 その中のメモリモアユール60内の制御レジスタ 70を作動させて必要なアータを供給させている。 BCUS8を制御する上記のシステムはでまり

る範囲で最も有効な例というわけではないが、追加の制御線の必要性を最小にしてプロセッサ間におこる干渉を防止している。好ましくは、各々の

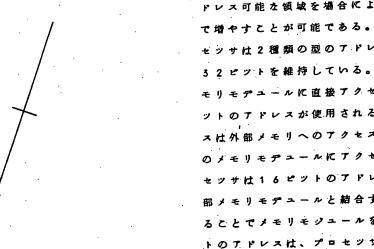
M S U 6 8 は 直接データイスのイス状況線1 6 5 に接続され、R A M 制御レジスタ7 0 が必要とする読出し / 書込み及び作動ピットを受取つている。各々のM S U 6 8 は対応するプロセッサに対し直接接続する2本の線を持つて構成され、R A M 制御アータを与えてテータイス5 6 を使用せずに地域的なアクセスを行つている。

及び2つのアータポート)を待ち行列に並べられ る必要があるので、小さたシフトレジスタがこれ を実行する。同様にしてもし他のメモリの要求が 既に未解決のままである場合、地域的なプロセッ サによつて要求されるメモリアクセスは延期され、 ビジー信号がもどつてくる。メモリ脱出しが実行 される時は、アータパスが使用可能になるのを待 つてから、アータワードを割合て額168を通つ て指示された割合て先に転送しなくてはならない。 書込みが実行される場合には、回帰信号は必要を い。どちらの場合でも、MSU68はただ待ち行 列レジスタから次の未解決のメモリの要求を引き だし、そのソースに信号を送つてメモリアタセス が現在可能であることを知らせる。MSU68は 次のソースが要求を再び発生するまで待機し、そ れから上記のように適当なメモリのアクセスを行 わせる。

当分野に通常の知識を持つ者には明らかなよりに、アドレスレジスタ 6 4、アータレジスタ 6 2 及び制御レジスタ 7 0 は M S U 6 8 とそれに対応

本実施例において、各々のメモリモデュールは、

するメモリモアユール60の間のインターフェー スとして使用される。



16ピットアドレスでアドレス指定される。これ によつて、4つのプロセッサの各々に対し直接ア ドレス可能な領域を場合によつて 6 4 K パイトま で増やすことが可能である。しかしながら、プロ セッサは2種類の型のアドレス、即ち16及び 32ピットを維持している。プロセッサ自身のメ モリモデユールに直接アクセスする為には16ピ ツトのアドレスが使用される。32ピツトアドレ スは外部メモリへのアクセスの為使用される。他 のメモリモデユールにアクセスする場合は、プロ セッサは16ピットのアドレスを送り、所望の内。 部メモリモデユールと結合する割合で信号を与え るごとでメモリモジュールを指定する。 3×2×ビツ トのアドレスは、プロセッサの制御に従つて外部 ナドレス又はマッピングアドレスのうちいずれか となる。外部アドレスとなるようアドレスが指示 される場合、アトレスは外部メモリインターフェ ースに送られてプロセスが実行される。さもなけ ればアドレスはメモリマッパーに送られる。メモ

リマッパーはアドレスが内部のものか外部のものかを決定する為連合して探索を行う。内部のものであれば、関連した内部アドレスは外部メモリインターフェースに送られる。

(状況ペスのエンド・アラウンド・ループ54 を含む)状況ペス52は4つのプロセツサPRO - P R 3 及び外部状況ポート 7 4 及び 7 5 を相互 接続している。状況パス52は桁上げ状況線190 桁上げ入力出力線191、オーパーフロー線192 負数線 1 9 4 セロ線 1 9 6 プロセッサ 同期線 198 及びシフト循環線199から成る1本の線のみを 有している。故に、エンド・アラウンド・ループ 5 4 を含めても状況パスは、たつた1 4 本の広さ しかない。各々のプロセッサは、プログラム可能 なスイッチである対応する一対の状況マルチプレ クサ48又は50を有している。これらのスイツ チは、選択的に且つプログラムに沿つて各々の ALU28の状況出力又は入力線を状況パス52 及びエンド・アラウンド・ループ54の両方を含 む状況パス線に、いずれかの方向を指定して接続

の未解決なメモリ要求が不均一に配分されることによつて、全てのプロセッサーは、そのメモリのアクセスを同時に受けとることはない。状況でれて、全でのでした。ないのではない。状況ではない。状況ではないのでは、0 L A 2 2 k を続される。状況を190はパレルシフタ30のリンクイン及びリンクアウトに接続され、プロセッサ同期線199はパレルシフタ30のリンクイン及びリンクアウトに接続される。外部状況ポート74及び756同様のプログラム可能な接続回路を有している。

本発明である再構成可能な多重プロセンサ機能 を提供する為共働する上記で示したような構造的 特徴はこれからさらに詳しく説明する。

第26、27及び28図は、本発明である再構成可能な集積回路のオペレーションの3つの主要なモードを示している。第26図は、全体的に独立するモードの組織を示している。このオペレー

している。第23から第25図は、状況マルチプ レクサ48及び50で選択された状況バス接続の いくつかの例を示している。プロセッサが独立し て動作する時、第23図で示すように状況線の接 統は必要とされず、状況マルチプレクサ48及び 50は状況ペス52及び54に開路を作りだす。 隣接するプロセッサがパイプライン構造で作動す る時、(例えばPR3の)テータ出力がPR2の 人力として与えられている場合、プロセッサ同期 銀198のみが接続される必要がある。最後に、 プロセッサPR3及びPR2が32ピット又はそ れ以上の規模のプロセッサの一部としてロックス テップ構成で作動される場合、プロセッサPR2 の状况出力は、全てプロセッサPR3に対する状 **况入力として接続される。プロセッサ同期級は、** ロックステップモードで使用され現在のオペレー ションが完了する前には確実に新しいオペレーシ ヨンが開始されないようにしている。例えばロッ クステップ構成のプロセッサがアクセスしている 全てのメモリモデュールに対し、他のソースから

ションではプロセッサPR0-PR3は単一チップ上に配置された実質的に4つの独立するプロセッサとして働いている。4つ別々の命令の流れが別個のプロセッサPR0-PR3に与えられ、独立するプロセッサ間に必要とされる唯一のインターフェースは、制御パス及びデータパスプロトコールによつてアクセスされるものである。

同じ構造はまた配列処理オペレーションを行えるようになつている。配列処理に於て、プロセッサ間の相互接続は独立モードの場合と同じである。配列処理と異る点は、各々のプロセッサが、同じ命令の流れを受けとつているということである。もちろん配列処理はまたプロセッサの2次的な組(例えけ 2つの32ピットプロセッサ)に基づき構成される。

第27図は内部的なロックステップモードで作動されるRICの例を示す。この例では、4つ全部のプロセッサが再構成されて単一の64ピットプロセッサとして作動するようになつている。こ

の構成では、制御イス14が単一の共通な命令の 流れを運んでいて、この命令の流れを全てのプロ セッサが受け取る。上配のように必要な同期桁上 け及び状況ピットは状況ペス52及び54によつ て通信が行われる。更にシフト及び循環連結が設 けられているので望みのピット又は循環オペレー ションをどれても64ピットワードでデータパス 58を介し実行することができる。(この連結に 関しては、テータパス56は、上記で示したよう にパイプラインモードで構成される。)1ピット シフト及び循環がシフト/循環線199によつて 実行される。RICをこのモードに正確にプログ ラムすることによつて、各々のプロセツサが64 ピットワードの16ピットセグメントの統出し又 は鲁込みを行い全てのプロセツサが 4 つのRAM メモリモデュールの対応する位置でとの読出し又 は書込みを同時に行りので、単一クロックサイク ル内においてRAMメモリ 6 6 に対する 6 4 ピツ トでのアクセスが可能となる。

第28図は、パイプラインモードで作動するよ

再構成を行う為には、3つの主要な型の割込みが使用される。第1の型の割込みは、他のプロセッサ(即ち、割込み先(interruptee))の資源にロックステップモードのオペレーションを設定するように要求する。とのモードでは、1つのプロ

う構成された R I C の例を示す。この構成におい て、4つのプロセッサは、もともとは単一のアー タの流れであつた連続するオペレーションを実行 している。即ち、全体的な命令の組は、(プログ ラマーによつて) 4 つのオペレーションの組に分 割される。この4つのオペレーションの組はそれ ぞれほぼ同じ時間を必要とする。そこで4つのプ ロセッサは各部分が連続するデータの流れのうち、 分割された命令プロセスの一部分のみを各々で実 行する。故に、とのようにして小分けされた命令 の組を用いてデータの流れを操作しなければなら たい場合、スループットは 4 倍になる。命令の組 はプログラマーによつて4つの命令のサブセット に分割されるので、チップレベルでは、命令の流 れは単に1つ1つがパイプラインモード内の各々 のプロセス段階に向けられた4つの別々で個別の 命令の流れとして現われる。上記で示した通り、 BCU58はアータペス56を小分けして、ペイ プラインモードで連続するステーツの間(即ち、 隣接するプロセッサの間)をデータが直接の転送

センサが共働単位の中の他のプロセンサのオペレ ーションを支配していて、故にこのプロセッサは ロックステップでの共働単位内のマスタプロセッ サと呼ばれる。この型の割込みのプロセスを(プ ロセッサがコンテクストスイッチを実行した後で) すぐに実行することを全てのプロセッサが受理す る場合以外は、割込みはこれ以上の動作をおこす ととはなく、マスタープロセツサによつて後で改 めて発生される。との場合、自分の割込みが拒絶 されたマスタプロセンサは、そのプロセスをソン フアの中に入力しておいて、さらにスケノユール を変更し、次のスケソユールによるプロセスの実 行を開始する。その後再度割込みを送ることもマ スタープロセツサの役割である。故にロツクステ ップでの割込みは、すぐにプロセスが実行可能な 時のみ受け入れられる。「どこそこのプロセッサ が必要とされている」「自分のプロセッサは、今 は使用可能である」「自分のプロセッサを解除せ よ」及び「どこそとのプロセッサーが解除される」 等といつたオペレーションを意味するプロセツサ

間での割込みの必要性を最小限にして、このプロトコールはプロセッサ間の通信を最小にしている。 とれによつて割込みに使用されるパスサイクルの 数が減つてプロセス及び割込みのスケデューリン かが複雑でなくなつている。単に拒絶された割込 みをパッファしたり、延期したりすることは、上 記で示した選択しりる例に比べて複雑なプロセス ではない。

ロックステンプアロセスでの割込のあたででの割込のカーストスインチは他の型のコークステンプに構成される場合、マイクロンクステンプに構成なテンプの名をは、マイクロングののでは、では、アロセンサのでは、アロセンサのでは、アロセンサのでは、アロングのでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アローのでは、アロングでは、アローのでは、アローのでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アロングでは、アローのではのでは、アローのでは、アローのでは、アローのでは、アローのでは、アローのでは、アローのでは

ち従来装置におけるマクロ命令に相当するものを 実行する間に割込みが発生可能である。本実施例 では、マイクロ命令を省略すれば複雑さを減少で きるが、これを使うことも可能である。マイクロ 命令を使用する意義には、2つの要素が存在する。 第1は、大規模CPUに多重チップを使用する場 合のような応用例では、その性能を最大限に利用 する為にマクロ命令が使用されないことである。 第2は、あるマイクロ命令はストリンク操作のよ うに非常に長くなるということである。

ロックステップ構造の中の従属プロセッサ (slave processor)の割込み管理回路は自分を 指示する割込みの存在を知る為に制御パス14の 鑑視を続けている。しかしながら、もし、ロック ステップで構成される共働単位内の切けれかるプロセッサがその共働単位内で現在実行と取る場合に ロセスより高い優先性を持つ割込みを鑑視しいる はマスタープロセッサは、ロックステックは される共働単位内の全てのプロセッサにおける適

ロックステップの共働単位内で作動している従 属プロセッサがロックステッププロセスより低い 優先顧位を持つ割りこみを受けとる場合、 従属プロセッサは、低い優先性のプロセスをパッファセ、 後にスケデュールし直す。故に、マスタープロセッサが、共働単位内の他のプロセッサのいずれか に向けた割込みを確認する必要のある間は、ロックステップより低い優先順位を持つているいかな る従属プロセッサの割込みに対し、マスタプロセッサの割込み管理回路はいかなる機能も実行する必要がない。それぞれの従属プロセッサ内の割込み管理回路12は低い優先順位の割込みをパッファする。

第2の型の割込みは割込み先プロセッサが実行する、いくつかの計算を特定することを要求する。(即ち、これはよく知られる・古典的・な割込みである。) この型の割込みの次には、実行すべきプロセスを特定する命令の流れが与えられる。この型の割込みは、その優先順位に従つてプロセスされる。このような割込みがサービスの為にスケアユールされた時には、割込みの後で与えられた第1番目の命令に従つてコンテクトスイッチを行っている。

第3の型の割込みは、パイプラインプロセスを 開始させる。パイプラインでの割込みの管理は、 ロックステップ型での割込み管理と同様である。 マスタープロセッサがパイプラインの割込みを送 り出すと、これを受けとつた全てのプロセッサは、

自分がパイプラインプロセスに参加できるかを信 号で知らせる。受取つたプロセンサが全てそろつ て参加できない場合、割込みは無効となつて後で 再び統行される。同様にパイプラインプロセスに おけるマスタープロセツサは、共働単位内のいず れかのプロセッサに向けられる割込みを鑑視して パイプラインプロセスより高い優先順位を持つ割 込を実行している。従属プロセツサは低い優先性 の割込みのみをパツファする。 ペイプラインでの 割込みの制御とロックステップでの割込みの制御 との間の主な違いは、パイプライン割込みプロセ スでの従属プロセッサがそのそれぞれの持つマイ クロシーケンサ 3 6 を使用し独自のマイクロ命令 の庞れを実行していることである。故にそれぞれ の従属プロセッサのマイクロシーケンサ36内に 含まれるコンテクストは保持されたままである必 要がある。

受源が共用されている場合、前に述べたように アットロックの発生は、非常に危険であつて必ず 避けなければならない。例えばプロセッサ PR 1

の8本の低いオーダーの線に示される256の優先順位がシステム内に存在できる。割込みが認められパッファされる時はいつでも、優先順位に関する情報もパッファされる。パッファされた割込みがサービスの為にスケジュールされる時、8ピットの優先性に関する情報を含む割込み制御ワードがとりだされプロセスを開始させる。

 及びPROがそれぞれプロセッサPR2及びPR3、 両方の費源を使いたい場合、またプロセツサ PRO がプロセッサPR3を支配しようとしている一方 でプロセッサPR1ができ続きプロセッサPR2 を支配している場合、もしもプロセツサPR1及 びPROがそれぞれの可動できないプロセンサ PR2 ZはPR3が可動できるようになるのをた だ待つようにだけプログラムされているとすると、 アッドロックが起こりうる。本発明においては、 いくつかの手段を講じてアッドロックを防いてい る。第1に各々の実行中のプロセス及び各々の割 こみには、プログラマによつて独得な優先順位が 与えられる。概念的には、各々のプロセスにその プロセスの優先順位及びプロセスを開始させる割 込みの優先順位と同一の名前をつけると考えるこ とがてきる。システム内で実行中の全てのプロセ スは、異る優先順位をそれぞれ持つ為、より高い 優先順位を持つ割込みが割合てプロセッサを先収 するので行き詰まりは起こり得ない。本実施例に 於ては、1回の割込み期間中には、アドレスペス

存否といつたロックステップ内の相対位置によつ て時々わずかな違いはある。)ロックステップで 接続するプロセンサ間における違いは、これらプ ロセンサの位置がプロセンサ間のハードウエアの 相互接続を決定していて、マスタプロセツサが共 働単位内の全てのプロセッサに対しより高い優先 順位の割込みを実行していることである。ペイプ ラインプロセスでは、各々のプロセツサは、同じ 割込みで割込みが行われ、もともとは各々のプロ セッサは同じ命令の流れを処理しパイプラインブ ロセスを行つている。引き硫きペイプラインプロ セス内の各々のプロセツサは、異るマイクロ命令 の流れを実行することができる。次に、プロセツ サは元の共通なマイクロ命令の流れをそれぞれの 持つ場所の数によつて分岐し、それに対応する通 当な分岐を選択し各々のプロセッサに対する別や のマイクロ命令の流れを作る。 パイプラインモー ド内の各々のアロセツサは別々のマイクロ命令ル ーチンを行うととができても、全てのプロセツサ は、チップを管理するという目的では同じプロセ

スを実行していると考えられる。パイプラインでの共働単位内のマスタープロセンサは、ロンクステンププロセスと同様に単位全体に対しより高い優先性を持つ割込みが処理される。 1 つのプロセッサのみを必要とするプロセスは、多重プロセッサでのプロセスを管理する為に必要としたプロトコールは必要としない。

可能にする望ましいとの特性は、この後に述べて表現できる。にいるのでは、いったのでは、いったのでは、いったのでは、いったのでは、いったのでは、いったのでは、いったのでは、いったのでは、できる。このようながある。このは、のでは、できる。このようながでは、できる。このようながは、できる。このは、のでは、できる。このは、のでは、いったのでは、できる。と性のでは、できる。とは、いったのでは、できる。とは、いったのでは、できる。とは、ないのでは、ないいのでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないではないでは、ないではないでは、ない

256の優先性レベルを用意すればたいていの 応用例には充分である。故に本実施例ではこれを 採用している。しかし、もつとたくさんの優先性 レベルを用意することが望ましい場合、例えば8 ピットによる優先順位の特定より10ピットを使 うことはもちろんとるにたらない問題である。 256の優先性レベルを用意することは1度に

256のみの有効なプロセスが存在することを意 味する。有効でないプロセスは数に制限なく存在 可能である。

例えば本発明による再構成可能な I Cを用いて 3 2 ピット C P U に対抗することを仮定する。再構成可能な I C におけるプロセスは以下のような タスクが与えられている。即ち命令とり出し、コンテクストスイッチ、命令間の対抗、外部割込 シレベルごとに 1 つのプロセス、自己テストで進しているように思える。

各々のプロセッサ内の割込み管理回路12の主
なタスクは、割込み信号プロトコールに従みで信
号を受取りまた発生することである。割込み管理
回路12は割込み信号を送信及び受信していて

動しい割込みが受けとつた時はいつもスケテュー

り16に信号を送り、現在実行中のプロセスの優先順位を比較した新しい割込みの優先順位を記し

せる。スケデューラ16及び割込み管理回路12
は両方とも現在実行中のタスクの優先順位を記憶

している必要がある。新しい割込みが現在実行中 のプロセスを統行させる時、スケテユーラー1 6 はただちに新しいプロセスがシーケンサ36の内 容を含めた全体的コンテクストを記憶することを 必要とするか否か又は、部分的なコンテクストス イッチのみを必要とするかを確認したくてはたら ない。必要なコンテクストスイッチについての情 報は、高いオーダのアドレスピット84でコード 化される。優先順位の特定には8ピットしか必要 としないので必要なコンテクストスイッチの程度 といつたような割込みに関する追加情報をコード 化する為に6ピットが使用される。受取つた割込 みの優先順位がより低いものであつてその為パッ ファされる場合、とのようセプロセスは必然的に ロックステッププロセスでないので、ペッファさ れた優先順位が最終的にスケアユールされる時に は、全部のコンテクストスイッチが必要となる。 ロックステップのプロセスだけは、全部のコンテ クストスイッチを必要としたい。このような場合、 スケデューラは適当なコンテクストを記憶し、現

在のタスクをペッファし、プロセッサが新しいプロセスを開始する用意ができたことを割込み管理 回路12に知らせる。

スケデユーラ16の構造及びオペレーションは、 第29図を参照してこれからさらに詳しく説明を 行り。スケデユーラ16は優先順位によつて有効 なプロセスのリストを作つておかたくてはたらた い。有効プロセスとは、スケアユールすることの できる最も高い優先順位を持つ時、実行を開始す るプロセスである。ハードウェアを節約する為に 本実施例では、1ピット毎の256のリスト即ち、 有効なタスクを記憶する為の有効プロセスパツフ **ア200を保持している。特定のプロセンサが1** と名づける有効プロセス(即ちしの優先性を持ち 実行を待つプロセス)を有している時はいつでも、 スケテユーラ16の中のとのプロセッサに対応す る有効プロセスパッファ200の1番目の位置に 1 含まれている。有効プロセスペッファ200内 のプロセスは実行の為のスケテユールが行われる 時には、パッフア200内に於るこの位置(これ

スケアユーラ16のオペレーションは第30図の流れ図で示される。スケアユーラ16は、割みみの発生、有効なプロセスのプロック、又は、アロセスの完成の3つの起こりうる原因(勝発要)の1つによつて作動されるようになる。プロセスとは、必要な資源が使用できない為実行の統行を中止させられるものである。例

プロックされたプロセスは、もし必要であれば タイマー 2 0 6 を使つてプログラムすることがで まる。このようなプロセスがプロックされる時、 プロセスは命令でタイマーをプログラムする。タ イマー 2 0 6 がセロまでカウントダウンする時、

スケアユーラ16を作動させる誘発要素が生じる。 この要素によつてスケデューラ16は適常のスケ アユールサイクルを実行するようにたる。タイマ - - 2 0 6 をセットしたプロックされたプロセスが 最も高い優先順位を持つていれば、スケデューリ ングが行われる。しかしたがら制御パス14から 割込みを受けとる場合、又は他のプロセスがプロ ツクされる場合又はプロセスが完了した場合には タイマー206は作動しなくたる。このよりた場 合には通常のスケアユールサイクルが開始され、 故にタイマー機能が不要になる為タイマー206 は作動しなくなる。このプロックされたプロセス に対するスケアユーリング法は、一方ではプロツ クされたプロセスに引き続き、チップの資源を使 用させいつ必要な資源の用意ができるか判断させ ていて、また他方ではより高い優先順位を持つプ ロセスを必要な時間より長くプロックさせている。 間を調整するものである。との調整は低価格のハ ードウエアですみ、良好なスケデユーリング動作 を得ることが期待される。しかし、現在のプロセ

スの実行を観行しつつ、現在のプロセスより高い 優先順位を次のプロセスが持つようにすることは、 スケアユーラ16のオペレーションをいくらか複 継にすることになる。

スケデューラ16が割込みによつて呼び出され る時、(レジスタ202から入力された)現在の プロセスの優先順位及び(レジスタ204から入 力された)次のプロセスの優先順位の高さと共化 受取つた割込みの優先順位がコンパレータ212 化よつて比較される。新しく受取つた割込みが3 つの中で一番高い優先顧位を持つ場合のみ先取が 起とる。先取する必要がある場合、現在のプロセ スを停止させコンテクストスイッチが実行された 後でだけ新しく受けとつた割込みが開始される。 スケテューラは次に次のプロセス及び現在のプロ セヌの優先顧位の高さを次の優先顧位の為のレジ スタ204に入力する。有効プロセスパッファ 200内の対応する優先性レベルに1を書きとむ ことによつて現在のプロセスがパッファされる。 先取する必要がない場合、新しく受けとつた割込

ICWのタイプフィールドは命令オプコードに 類似する。タイプフィールドは 4 ピットであるが、 3 つの型の ICWが規定されている。タイプ 0 は 単一プロセッサによるプロセスの為であり、タイ プ1 はロックステッププロセスの為、またタイプ

みは、有効プロセスパツファ200にパッファさ れ、パッファされた割込みに関する情報はこれ以 後受けとり側のプロセツサに記憶される必要はな い。次の優先先願位と割込みの優先順位のうち高 い方が次の優先順位の為のレジスタ204に入力 される。故にある場合では次の優先順位の為のレ シスタ204が有効を情報を内容として持たない よりにすることができる。これは、有効プロセス パッファ200によつてリニアを検索を行い次に、 最も高い優先順位を持つプロセスを発見すること が時として必要になるからである。必要とされる 時に次の優先順位の為のレジスタ204の内容が 有効でなかのた場合、スケデューラ160オペレ ーションは他に有効なプロセスが発見できない場 合も含めて有効なテータが見つかるまで停止する。 最終的にプロセスを完了することによる作動をお とす原因が受けとられると、(これはプロセス状 況ピットを通してスケアユーラ16に知らされる) 次のプロセスが開始し、次に高い優先履位を持つ プロセスの検索が開始される。

2 はパイプラインプロセスの為のものである。タイプフィールドは割込み管理回路に対する命令と しても使用され以後の割込みの発生を命じている。

位置フィールドは、予定された割込みを受けと つたかを確認している。このフィールドには各々 のプロセッサに対し1ピットが含まれていて各々 のピット位置における内容を使用して、それに対 応するプロセッサが割込みを受けとるべきである ことを示している。

優先性マスクフィールドはプロセスの名前又は 優先履位とは異る実行の優先履位を特定する為に 使用される。言いかえれば、優先性マスクロ位・ ルドが使用される場合、プロセンの優先履位というよりむしろ)と考えを の優先履位というよりむしろ)と考える。 の優先履位(bidding priority) と考えを使用される。 ができる。PMピットは、優先性マスクが使用される。 のできるが否がを特定する為に使用される。 のおこれるができる可能性をあめる為に使用される。 のプロセスにも与 そられていない優先値を使うように限定されている。 さもなければ、2つのプロセスが同じ優先順位で費碌をとりあう時、アッドロックが起こりうるからである。

次の優先性フィールドは同一プロセスに多重質 先レペルを与えることができる。このフィールド はNTピットが1である場合のみ有効となる。と の機能によつて、ランタイムで規定される優先順 位をプロセスに与えられる。との機能は、プロセ スの非常事態がやがて変化する時に有効となる。 例えばプロセスは、特定の優先性レベルを持つ制 込みを、必要なサービスを予期して発生するとと ができる。割込みが直ちに動作を開始させない場 合ても、割込みのイニシェータが後にプロセスを 開始させる。しかしながら、時間的な遅れによつ て(本実施例に於て)割込みのサービスを受ける 必要性がさらに急を告するようになるのでイニシ エータは次に量も高い優先順位を持つ割込みが発 生可能になる。次に高い優先順位についての情報 **壮次に高い優先順位の為のフィールド内に含まれ**

ている。との機能を利用する別の方法としては同一プロセスの多重処理を開始する方法がある。このモードのオペレーションでは、ある優先性レベルへと位置フィールドが変わる場合に、並列処理が可能となる。同じ位置フィールドが使用される場合には回帰的ルーテンを使用することができる。

最後に、制御記憶アドレスフィールドは現在の 割込みによつて呼び出されたプロセスマイクロル ーチンのマイクロ命令のアドレスを指示している。

前に述べたように、割込みが送られた時には、 14本の制御記憶アドレス線84のうちの8本の 線のみが使用されて優先性がコード化される。故 に、残る利用可能な6ピットのうち1ピットを シテクストスイッチを全部統行するか又は一部 でたれ以外のもう1ピットは割込みがただちにプ ロセスを実行しない場合、割込みをパッファる かどうかの判断の為に使用される。故に第32図 は割込みが送られる時の制御記憶アドレス線84

のフォーマットを示す。

劉込みシステムのオペレーションをさらに明ら かにする為に、第33図は、プロセッサPR3が プロセッサPR1に対し割込みを発生した場合の サンプル割込みに相当するタイミング表を示して いる。タイムnにおいてプロセッサPR3が制御 パス14を支配していて、(線13上に)自分が 割込みのソースであるという信号を与えていて(載 D R 1 上には)割込み先がプロセッサ P R 1 で あるという信号を与えている。同じこのメイムに 於ては現在の割込みが確認されるまでは他の割込 みが制御額14を通つて転送されることはないの でプロセッサPR3は、割込み準備級104の電 位を引き下げる。次のクロツク間隔では、プロセ ツサPR1は、劉込みペスト1の適当な額の賃位 を上げることで劉込みの確認を行い、コンテクス トスイツチを実行した後でプロセツサPR1が割 込みのプロセスを開始させたことを知らせている。 次にプロセッサPR3は、割込みによつて知らさ れたプロセスを開始させる為のマイクロ命令のア

ドレスを転送するアドレスパス84を操作する。 プロセッサPRIがそのコンテクストスイッチの 実行を完了すると、プロセッサPRIがこのマイ クロ命令のアドレスをロードし、割込みパス13 及び割込み準備線104の電位を引き上げて(又 は引き下げを止めて)割込みが再び受けとれる状 額となつたことを知らせる。

てとまでは再構成可能を機能及び多重プロセッサ機能を提供する割込みプロトコールの組織を説明してきた。再構成可能機能を提供する為に必要な命令構造に使用するこの他の構成要素は、DLA22及びDLAデコーダ26によつて通訳される時に、状況パスマルチプレクサ48及び50の再構成を特定するか又は、BCU58の内の1つに含まれるパイディレクショナルスイッチ178、180及び182のオペレーションを特定する命令を有している。

本発明の再構成可能な I C の実施例は、 8 4 ピンペッケージの中に含まれる。 (6 4 ピンでデータ及びアドレスをまかなり 1 1 2 ピンペッケージ

も選択できるがあまり経済的でない。)

ある種の構成に関しては、84ピンパッケージをフルに必要としない。故に、このような応用例の為に設計されたRICを中間的な量で製造する為には、もつと安価なペッケージを使用することができる。

本発明のRICの為に好ましいパッケージは、例えばここに参照として示すエレクトロニクスマガジン1981年6月30日号の39から40頁で記載されるような84ピンプラスチック・リード・チップキャリアである。しかし第34図ではRICが超大規模DIPパッケージの中に含まれる場合のピン配置を便宜上示す。

本実施例のIRCは2つの16ピットアータ/アドレスポートを有している。各々のポートはアータ及びアドレスを運搬する為の16本のパイディレクショナル観を有している。ポート1におけるアータ/アドレスピンは、1から16まで、ポート2のピンは26から41までの番号がふつてある。アータポート2の対応するアータポート1

ることができる。外部アータポートには主として 2つの機能がある。 第1の機能は、外部アータボ ート72及び78としての役目である。テータポ ートの主要機能の一つは、内部データパス56と 外部アータポートピンの間のインターフェースと しての役目である。実際上これの意味することは、 アータポートが内部命令を受けとつてアータ及び アドレスを外部に送る機能を持つということであ つて、データポートはこの機能を果たし、それを 適当な信号にして外部ピンに送ることができる。 第2にデータポートは、外部ピンから情報を受け とり、次に適当に変換して、適当にその信号を内 部 R A M ハ ス 5 .6 に送つている。 第 2 の 主要機能 は、プロック転送モードである。これは、例えば 1つのアドレス及びデータワードを外部に送る命 令を送るかわりに、内部的に制御及び命令を受け る多重アドレス及びデータワードを送り出してい る比較的一般的な命令を送つている点で上記に説 明した他のオペレーションとはわずかに異つてい

る。

のピンは、機能的に等しいのでポート1で働くピ ンのみに関し示す。第1及び第2図で示す外部ア -- タポートF2及びF3にデータポート1及び2 が対応する。簡単なピンの配線に加えて、外部デ - タポート72及び73は、1個以上のRIC、 外部メモリ、1/0装置及びアドレス装置の間を 結ぶ共有外部パスの制御に対し仲裁を行り和職信 号(handshake signals)(ピン17及び18) を有している。各々のポートは、パスでのデータ 及びアドレスの送信及び受信の同期を行う為の追 加のピン(22及び23)を有している。各々の ポートは、パスの状況、及びパイデイレクショナ ルカー対のプロセッサタグアイテンテイフアイヤ - (·2 4 及び 2 5) に 信号を送るパイデイレクシ ヨナルなる本の糖の組(ピン19ー21)も有し ている。アータポート1と2は独立している。し かしながら内部的には、両方のポートに同じオペ レーションを回帰的に実行させ、外部的には2つ のポートを1つのポートのように扱うことでこれ らのポートを単一の大きなポートとして作動させ

従来において、データ又はアドレスの内の最上位の固まり(chunk)は第1のサイクルで送られ、それに連続するサイクルにおいて次次とより下位の固まりが送り出される。全てのアドレス又はデータの固まりは最初の(最上位の)固まりが送られた同じポートから送られる。

これらの2つのデータポートはチップ上の全てのプロセッサに共通する。2つ以上のプロセッサを持ついかなるプロセッサ又はいかなる内部構成も、いずれかのデータポートを使用可能である。ポートは、プロセッサ内のメモリマッパー34によつて選択される。

以下で述べる外部通信プロトコールに関する機能に加えて、外部データポート72及び73もプロセッサによるデータパスプロトコールの使用に関し、上記で説明したものと全く同じ回路を有しているので、外部プロセッサもまたチップ上のメモリにアクセス可能である。

特開昭58-58672(31)

アータパスの仲穀 共有のアータイスを仲載す る機能が備えられている。各々のRICは、外部 仲戦回路、マスタースレープ機構、又はラウンド ョピン仲裁機構で動作する。 R I C の動作が開始 すると、仲裁モードが指示される。仲裁信号はア ータパス可動(DPAV)及びデータパス容認 .(DPGR)信号と呼ばれる。信号はポート1 に 対しては DPA V 1 及び DP GR 1 (ピン17と18)、 オート2に対してはDPAV2及びDPGR2(ピン 42と43)と表示がつけられる。以後とれらの 信号の表示は2つの同一なポートの間を区別する 為に参照番号を使わずに参照する。外部仲裁回路 モードが使用される時RICがプロセスを開始し、 外部回路に接続するDPAV出力信号の電位を上 けるととによつてパスを支配する。

仲戦機構がプロセッサの要求に対しアータパスが使用可能であるか判断し、要求元のDPGR信号の電位がひき上げられる。マスタースレープモードでは、マスターRICが常にパスを制御している。従属RICがパスを使用したい場合には要

状況を示するつのピン(19-21及び44-46)を有する。アータパスを制御している使用中のプロセッサはパイデイレクショナルピンに出力してデータパスの状況を知らせる。状況ピンの配置は、ポート1に関しテーブル1にリストしてある。(ポート2はピン44-46が第34図のピン19-12に相当することを除けば同一である。)

	テー:	ナル1	アータパスピン配置
e > .			
1 9.	2 0	2 1	機 能
0	0	٥٠	隣接するRICへの書込み
ō	0	1	隣接するRICからの読出し
0	1	0 .	割合てアドレスへの書込み
0	1	1	割合てアドレスからの銃出し
1	0	0	メモリへの書込み
1	0 '	1	メモリからの銃出し
1	1	0	Ⅰ∕○ 装置への客込み
1	1	1	Ⅰ/□ 装置からの読出し

求をDPAV信号でマスターに送つている。マス ターは、 D P G R 信号の電位を上げることでパス が使用可能であることを知らせる。この他のモー ドの仲裁機構としてはラウンドロビン機構がある。 との機構では、論理 1 がデータパスを使用するプ ロセツサの間を循環している。RICがデータル スのオペレーションを完了しているか又は、続行 中のものがたい場合、RICはそのDPARの置 位を引きあげる。とれは、隣接するRICの DPGR信号に接続される。テータパスオペレー ションが統行中である場合、DPGR信号が1亿 たると、RICがアータペスを支配するようにな る。さもなければRICはそのDPGR信号の電 位を上げる。パスを使用できなかつたRICは他 の資源がいずれもペスの使用を必要としていたい と判断した場合にこのRICは循環している1を トラップする。そとで(もし存在すれば)同期を 維持する為にとのRICはそのDPGRを引きる げて1を再び循環させる。

アータパス状況: 各々のポートがアータパスの

データパスの状況はアータパスオペレーション の型式を示している。データパスオペレーション に関しては 4 つの割当て先が存在しりる。即ち、 割当てられたRIC、アータ転送の最初の部分に よつて特定されたアドレスによる割当て、システ ムメモリ又はシステム1/0 ユニットの4つである。 読出し又は書込みオペレーションはこれら4つの 割合てのいすれても実行可能である。いずれかの 割合て先に転送される16ピットアドレスユニッ ト及び16ピットテータユニットの実際の数は、 RICのプログラムによつて又は、割合てのハー ドウェアによつて決定される。直接的な通信は隣 接する1つのRICに対してのみ有効である。割 当てアドレスモードはアータパスオペレーション に対し1つ又は複数のソースを特定する一般的な 方法である。データ転送の第1の部分は1つ以上 の割合でを決定するアドレスを特定している。割 合てアドレスを含む16ピットユニットの数は、 使用者によつて特定される。とのモードでは、ア ドレスは、データパス上の全ての受信プロセッサ

に送られる。受信側は、アドレスが自分の持つアドレスの1つであるかを判断する。全てのアドレスを受取つたプロセッサは、データペスオペレーションの残り部分を分担し続行する。メモリ及びレーションに関してのアドレスの長さ及びデータの長さのフォーマットも使用者によつて特定される。

アータ転送同期: これら2つのピンは、ソースと割あて先の間のアータパス上をアータが正確に 転送されていることを確実にする為に必要とされる。これらのピンは、情報転送可能(IA)と情報受信(IR)である。情報転送に関するプロト

コールは、以下の通りである。アータでスの側位を下げる。ソースはただレスで電位が上げる。ソースはアータは、1、まで電位が上げる。リA 信号を発けていた。リータではないでは、1、まではなってでは、カースは、一名では、カースははできる。のでは、カースはは、カースはは、カースはは、カースを信仰がアースは、通常では、カースを信仰が引き上げらいる。は、全にの受信できる。ない、全にの受信できる。は、で低い電位のまま維持される。

要約すると、 アータパスが特定されるととで融通のきく仲裁プロセスを持つ仲裁アータパス回路網が構成される。情報転送の割当ては、 割当てをアレスする機能を持つので一般的なものである。情報のフォーマットはRICをプログラムし、メモリ及び 1/0 システムを構成することで特定されるので一般的なものである。最後に、情報の転送

は、ある点からある点の間でも又は間にいくつか の分骸を含むもの(マルチドロップ)であつても よい。

割込みポート(ピン51-58)はこの目的を 果たしている。第1の目的は、従来のマイクロコ ンピュータ及びマイクロプロセッサが行つていた。 のと同様に外部からの割込みを受けとりプロセス を行りことである。割込みの概念は、他の受信側 プロセッサに割込みを送信する機能とともにこの 従来的を目的も達成できるよう一般化される。と の一般化によつてチップ内部の通信が可能となる。 チップ内部の通信を可能にするという目的は、 RICにタスクをコーディネイトし情報を転送す る役目である。チップ内部の通信システムはチッ プ間通信の命令 (communique)の部分を転送する 為に使用される。情報伝送のデータ部分はメモリ 間で通信される。例えば、デイスク読出しオペレ - ションは、RICの割込みポートを使つてデイ スク制御器に命令を送るととによつて開始される。 アータ転送は、アイスクシステム及びメモリシス…

特開昭58-58G72 (33)

テムの間の個別なテータパスにおいて行われる。 <u> 劉込みパス仲載</u>: RICの割込みポートは8本 のピン51-58を有している。ピン57-58 は割込みを送信中に使用される共有資源の要求を 仲載する為提供される3つのモードの仲載が維持 されている。第10モードは、ラウンドロピン機 構で仲載される共通の割込みパスを維持している。 この機構の中で「1」の信号がチップの間を循環 して上記で示したように割込み資産を配分してい る。あるチップに於る割込み可能(I A) 出力 (ピン58)が欝装するチップの割込み許可(IG) 入力(ピン57)に接続される。IG信号がある チップで「1」になる時とのチップは翻込みを発 生するとどができる。送信すべき割込みがそのチ ンプに存在しない場合、! A 信号の電位が上昇す る。第2のモードはデータポート仲歌の方針で説 明したのと同じマスタースレープモードである。 通常は、マスターRICがパスを制御している。 従属RICがマスターのIG入力信号を上昇させ てアクセスを要求している場合、マスターRIC

は、好きな時にマスターのIG信号の電位を上げ て選択的に従属RICに対するバスの支配を得る。 も51つの仲裁モードは各々のチップの割込み町 能及び割込み許可信号を外部仲裁ハードウェアに 接続して行う。RICが送信すべき割込みを有す る時、RICはIA信号の電位を上げる。割込み ポートが割込みの要求側によつて使用可能な状態 にある時、外部ハードウェアがIG信号の電位を 上げる。3つの仲裁機構を用意する理由は応用に 対する一般性を与える為である。ラウンド・ロビ ン仲載機構では、少数のRICを接続して内部通 信を可能にする経済的な方法を提供している。 マ スタースレープ機構では、多重な情報処理機能を 持つ装置をコーテイネイトする為の一般的を方法 の使用を可能にする。RICを外部割込み管理回 路に付加できる機能性を有することで、チップ内 部通信に用いる回路網を思いのままに構成すると とが可能となつている。

割込み情報: ポートの4本のピン53-56は、 外部割込み情報専用のものである。外部割込み情

報プロトコールは、最大限に使用者が規定できる よりに特定される部分は最小にしてある。また情 報プロトコールはアドレスとデータとの区別に関 して示している。また、プロトコールはメッセー 2の長さも示している。ととに示すものに関する 特徽を以下に説明する。情報プロトコールは、あ らゆる情報の第1番めの部分が割込みの受取り手 を駆定するアドレスであることを示している。ア ドレスの長さは使用者によつて指定される。割込 みが送られる時は、共通な割込みパス上の全ての チップがアドレスを受けとり、それを記憶する。 以下で規定されるように、割込み状況信号は情報 額がアドレスを選んでいるのかデータを選んでい るのかを知らせる。状況がアドレスピットが送信 されていることを示す限り、受信側のRICはア アレス部分をパツファしておく。 割当てア アレス が送信された後、各々の受信側RICはそのアド レスを使つてチップ上のRAMメモリ 6 6 内のピ ツトにアクセスする。N個のアドレスピットが送 られる場合、高いオーダーのNー3個のピットを

使用して内部メモリのテーブル内のハイトにアドロスする。とのハイトはRICの外部割込み管理の下ドレスピットがとのハイトの中から11」である。との選択されたピットが「1」であるとでいる。とのテップが割込みの割当て先でるまでもとを示す。とのRICは何か送信されてくるまでも込みと共働する。とのアドレス探索機構は、任意につけ加えられる。単純な割込み機構では、受けとつたどの割込みもいずれかの受け取り手に対し送信するととができる。

通信ポートの残る2本のピン51及び52は、 割込みパスの状況を示す為に使用される。ピンの 記畳はテープル2に示される。

テーナル 2

通信状況ピンの配置・

|S1 |S2 | (ピン51) (ピン52) | 1 | 見信側準備 | 1 | 見信側準備 | 1 | ファータ転送 | 0 | 情報転送完了

2本の割込み状況線は2つの目的に使用される。 第1の目的は、ソースと割あて先の間にに非同期の 和職信号を与えるとである。もう11つからとである。を区別けるとである。を区別はである。を区別はである。を区別はである。のからはでいる。のからはでは、152年ののはでは、152年ののでは、151年のでは、151年のでは、151年のでは、151年のでは、151年のでは、151年のでは、151年のでは、151年のでは、151年のでは、151年のでは、151年でのでは、151年でのでは、151年でのでは、151年でのでは、151年でのでは、151年では、1

味する。もしラウンドロピン仲裁機構が使用される場合、送信側が削込み可能信号の電位を上げて次の割込みを送信するRICの選択を開始させる。マスタースレープオペレーションが使用され、送信側が従属RICである場合、マスターが割込み資源の制御を行う。マスターが送信側である場合、従属RICに対し割込み資源をせりあうことができることを知らせる。

IS1個号の電位をゼロに引き下げる。チップが 受取つた情報を処理した後でとのチップは151 信号をフロートの状態にする。全ての受取り側 RICが情報のプロセスを完了すると、IS1信 号は「1」を示すよりになる。そして状況は1.1 となる。送信側は送信可能な状態の次のニブルが もしあればそれを調査する。次のアータの形式は 状況線によつて決定される。状況01は、アドレ ス情報に対応し、状況10はデータ情報に対応す る。データ情報が送られると、送信側は、アドレ ス情報の転送に使用したのと同じプロトコールを 使用する。唯一の相違点は、情報が送られる後に、 送信側がIS1及びIS2両方の信号をフロート の状態にすることである。最後のニブルが送られ た後で、送信側RICが状況00を出力し、網込 み情報プロックの終了したことを知らせる。選姫 の後に送信仰は状況信号をフロートの状態にする。 このことが受信側に割込みが終了したことを知ら せる。外部仲職機構が使用される場合は、劉込み の終了は次の劉込みの開始が可能であることも意

メッセーシプロック内の第2のパイトがメッセーシ内のパイト数を有している。第2のパイトが(ランタイム情報と同時に)10進法のゼロである場合、次の2パイトがメッセージプロック等の中のパイト数を有している。

况ピットによつて決定される。これらのピットが 1 1 であればラウントロピン仲裁機構を使用しこれらのピットが 0 0 を示せば外部仲裁機構を使用 する。マスタースレープ仲裁機構は 1 0 を示す場合に使用される。

れた通りのメッセージプロックが送り終わるまで 割込み管理回路がニブルを送る。メッセージが対けれた後で見つ外の形との内部には外の内に、外部割込みのではからないが、外部割込みを表したプロセンがに、対けている。とのようを発生したプロセンを開かりに書込みを対したが割込みを開かりに書込みをはいまれた場合であるプロセンは第36回に示す。

上記で示したように、共適割込みパス上の全てのRICは割当てアドレスを受けとり、これをそれぞれの持つ外部割込み管理回路76内にパッファナる。アドレスを受取つた後で、各々の外部割込み管理回路76がひとつのピットにアクセスし、それのあるそれぞれのチップが割込みの割当て先である場合、外部割込み管理回路76は残るメッセージをそのチップの内部RAM内にパッフ

部及び内部に対し回帰的に送信される割込みを示 す為に使用される。との型の割込みは以下で示す よりな、外部ロックステップに対する割込みに必 要とされる。とのパイトの一番左のニナルは全て 「1」である。右のニアルは、内部のどのプロセ ツサに割込みを行りかを示す為に使用される。ニ プルの最上位ピットが、PR3に対応し、次の最 上位ピットは、PR2に対応し、以下との通り対 応する。もし、右側ニナルのいずれかのピットに 「1」が含まれる場合、それに対応するプロセッ サは、そのプロセッサに対する翻込みを受けとつ ている。割あてアドレスの最後はセロのパイトで 位置を示される。外部割込み管理76かゼロのパ イトの存在を検索する時、もしゼロが存在すれば 割込みメッセージのテータ部分を送る。テータ部 分の終了は、またゼロのパイトで知らされる。次 に割込み管理回路 7 6 はゼロを検知した場合、ア ドレスのソースを送る。内部納込みデータ構造は、 第35回に示される。外部割込み管理回路に知ら されたメンセージアロックの長さによつて決定さ

アする。メッセージプロックのデータ部分の終了 までくると、割込み管理回路はゼロのパイトを書 きこみデータ部分の終了を示す。割込み管理回路 は「1」が送られてきた場合側込みのソースアド レスもパツファする。メツセージプロックを送り おえた後、割当て先RICの外部割込み管理回路 7 6 は、割当てアドレスを使用して内部 R A M 66 内の外部割込みマップテーブルにアクセスし、と れによつてRIC上のどのプロセツサが割込みを 受けとるのか又は割込みは内部的にどの程度の優 先性を持つのかを判断している。内部割込みの優 先性は、メッセージプロックの開始位置及びメッ セージの長さが書きとまれる外部割込みメッセー ソテーブル内の位置を指定する為に使用される。 さらに、外部制込み管理回路は削込みをチップ上 のプロセッサに送る。割込み管理回路は外部割込 みメツセージテーブル内の情報を使つてメッセー ソプロツクにアクセスしこれのプロセスを行う。

外部割込み管理回路が使用するRAM領域のメモリ管理は、割込みを送つたり受けたりするプロ

セッサーにより行われる。プロセッサが外部割込 みを送る時、劉込みはポインタをメツセージプロ ックにわたしている。外部割込み管理回路76が 割込みを送つた後に、送信したプロセツサには送 つた劉込みの状況が知らされる。劉込みが誤りた く送られた場合、プロセツサは改めてメツセージ プロックのメモリ領域の使用を請求できる。外部 割込み管理回路 7 6 は、プロセツサ P R C ~ PR3 に自分自身のメモリの管理を行わせる機能はない。 故に外部割込み管理回路76は、外部から受けと つたメッセージプロックを書きこむ為の 領域を確 保する為にメモリの管理を必要とする。外部制込 み管理回路はメツセージプロックを記憶しておく 為に2つのメモリポインタ:現在のメツセージブ ロックポインタ(CMB)及び次のメンセーシア ロックポイタ(NMB)を有している。 C MBが 有効であれば外部割込み管理回路76はこのポイ ンタをメッセージアロックの開始として使用し、 受取つたメッセージプロックの各々のペイトが書 自とまれた後でアドレスポインタをインクレメン

外部割込み管理76は開始時点で初期化される 最長プロックパラメータを有している。最大の長 さより長いメッセージプロックが送信される場合 外部割込み管理回路は「受け取り準備ができてい ない」という信号を割込みの送信側に送る。また 外部割込み管理回路はソースプロセッサを判断し

との割込みインターフェースを提供する目的は、 使用者が割込み機構を規定できるようにスペクト ルを提供する為である。最も簡単な割込み機構は 従来のマイクロプロセッサで使用される割込み機 構と類似している。とのより簡単な機構より更に 融通性を拡大する為には内部的にプログラム構造 を形成する必要がある。

状況ポート1(ピン59-67)及び状況ポー ト2(ピン68-76)である2つの状況ポート が提供される。状況ポートの信号は同一である。 故に状況ポート1のみに関し説明を行う。状況ポ ートの主要な機能の1つは、異るRIC上のロッ クステップモードの2つのプロセッサに信号を提 供することである。状況ポート1は、PRO又は PR1、又はロツクステップで接続されるPRO 及びPR1を外部プロセッサにロックステップで 接続する為に使用することができる。状況ポート 2は、PR2又はPR3に関し、あるいは、PR2 又はPR3がロックステップ内で最も重要なマス タープロセッサである内部のロックステップに関 し外部的にロックステップを形成する為に使用す ることができる。各々の状況ポートには、4つの 型のピン機能がある:即ち、ALUの結果状況、 桁上け連結、シフト/循環連結及びチップ内部の 同期である。状況ポート1(ピン59ー67)は、 内部状況パス52及び54に外部状況ポート75

(第1図を参照せよ)を通して接続される。同様にして状況ポート2は、外部状況ポート74(第1及び第2図で示す)を通して接続する。

ALUの結果状況: ALUの結果状況には4つの級59-62が存在する。負のCCが存在する。負のCCが存在する。負のCCが存在する。人では果状況と、格の結果状況となっておけれる状況というの信号は、各々外部的投稿というの信号は、各々外部的投稿というのではれる状況は一ト全でがある。とれら4つの信号は、各々外部を扱っているのではないのでは、ANDのAとしている。とないのでは、ANDのAとしている。とないのでは、ANDのAとしている。とないのでは、ANDのAとしている。とないのでは、ANDのAとしている。とほとんど同様である。

桁上げ連結: 桁上げ連結(carry linkage) は桁上げ信号(ピン63)及び桁下げ信号(ピン 64)を有している。あるRICの桁下げ信号は 次に高順位のRICの桁上げ信号と接続される。

ステップからはずれることができる。故にマイク 口命令をとりだす時間は、ロックステップで接続 されるプロセッサを有するRICの間で様々であ る。チップ間の同期ピンはフラグとしての役めを し、各々のプロセッサが先のマイクロ命令を完了 し次のマイクロ命令を取り出したことを知らせて むり次のマイクロ命令を実行する用意ができてい ることを示す。チップ間の同期ピンはワイヤー AND接続される。全ての外部的にロックステッ プで接続されるプロセッサの次のマイクロ命令を 実行する用意ができた時、チップ間の同期報の電 位が上がる。もし1つ以上のPRの用意ができて ない場合、線の電位は低くたる。同期線の電位が 高い時、次のクロックサイクルで実行が開始する。 (共通な外部ロックステップ内のPRを持つ全て のR I C は同じシステムクロックを使用したくて はならない。)実行が始まつた少し後で、チップ 内部同期線の電位は全てのPRが次のマイクロ命 今を実行する用意のできた状態になるまで低くな つている。PRが外部的にロックステップで接続

あるRICで完了した演算が使用される場合、最上位プロセッサは最下位プロセッサの桁上げ信号に接続される。

シフトノ循環連結・シフトノ循環連結(shift ノrotate linkage)は、外部的にロックステップで接結するプロセッサ間のシフトオペレーションを実行する為に使用される。RICのシフトノ循環高電位信号(ピン65)は、次に最上位のRICのシフトノ循環低電位信号(ピン66)に接続される。最上位RICのシフトノ循環低電位信号に接続されて所環連結が形成されている。

チップ間の同期: チップ間の同期(ピン76)を行う為には、外部的にロックステップで接続するプロセッサが確実にフェイズ内で同じ命令を実行するようにしなくてはならない。外部ロックステップ内のプロセッサは、同じRICの中の1つのRICの上に形成される他のプロセッサが外部のロックステップで接続するプロセッサとは独立して作動されることから、同期を行わずにロック

される時、マイクロ命令の実行中はPRに対する 割込みはおとつてはならない。との割込みの制限 によつて、マイクロ命令の実行が開始した後も外 部でロックステップ接続するプロセッサ間の同期 は確実に保たれる。この制限で得る利点は、状況 ポートのピンの為に他の同期手段を設ける必要が ないという点である。外部でロックステップで接 続十るプロセッサに関してはもり1つの事項があ る。外部のロンクステップ内のプロセッサに対す る割込みは、プロセッサの同期を妨害することに なるので、何込みによる効果を考慮しなくてはな らない。追加のピンあるいは追加のオーパーペツ ドを使わずに外部的なロックステップ接続の同期 を維持する為には、外部ロックステップに対する 割込みは、外部ロックステップ内の全ての M S P 化対して行われるよう制限されなくてはならない。 割込みのサプセットに割込みを実行することは可 能なのでとればあまり厳格な制限ではない。外部 ロックスチップ全体に対し割込みを送ることを必 要とするこの制限によつて、外部ロックステップ

内のちょうどプロセスを開始しょうとしているプロセンサに割込みの名前を知らせる必要性を省くことができる。外部ロックステップ全体に送みが行われる外部ロックステップを有する全てのRICが同じ割込みを管理回路は、受取つたオークをでのプロセッサは同じオーダーで割込みを受取る。RICの自己に対する割込み(selt

Interrupt)に関しての特徴は、外部ロックステップに対する割込みが割込み先である外部ロックステップ内のプロセッサを有するRIC内で発生される場合に必要となる。前に述べたように、自己に対する割込みは、割込みの送信側にとつてそ、の送信側自身が受信も行つているものとして取り扱われる。

上記で説明した通り、外部ロックステンプ内のプロセッサはマイクロ命令の実行中は割込みが行われることはない。マイクロ命令が終了すると割

号を発生することができる。例をば、RICに使用されるCRT制御回路の場合、N信号は内部的に制御されて水平同期信号を発生する。また、チップ間同期信号は内部制御システム(即ち LA 2 2 等)に対する直接の割込みの時に使用される。例えば、チップ間同期信号は、内部的には、外部クロックとして通訳される。この外部クロックは、各クロックサイクルの期間に所定のオペレーションを発生させる。

外部ロックステップの全てのプロセスは、割込みによつて開始される。RICのリセットによつて外部ロックステップ内のマスタープロセッサが自己に対する割込みを発生し、最ープロセッサは自己に対する割込みを発生し、最ー、最近後先順位を持つ別々のプロセスを開始する・リセットインRICピッィフ)及びリセット

リセットインドー(ピンイィ)及びリピンドクトRO(ピン78)の2本のチップ制御線が提供されている。全てのRICから接続するRI及びRO信号は別々に接続される。RI信号はアク

状況ポートにはもり1つ重要な機能がある。外部ALU状況ピンNZCVは、制御DLA22への入力として実際の内部ALU状況ピンを配置することによつて決定される値を持つ。制御DLA22への入力は外部ピンに送られた値を発生する。故に上記で示したような機能によつて、リアルタイム信号を発生する為に使用される実際の外部信

テイプで高い電位である。R!信号が「1」を示すまで電位を上昇されるとRICは自分自身を初期化を開始しオペレーションに傭える。RICが初期化オペレーションを完了した時、電位を低くしてあるRO信号はフロートの状態になる。全てのRICが初期化を完了すると、RO信号は高い電位となりシステムが初期化を完了したとを示す。

チップが初期化されると、プロセッサPR3はただちに最も高い優先順位255を持つプロセスを開始させる。この場合プロセッサPR3がマスターである。プロセッサPR3は次にチップ上のRAM66の位置「0」に固定Tドレスをロードし、プロセッサPR3はそこで他のプロセッサに対する割込みを行いこれに必要なプロセスを開始する。

好ましい実施例において、この中のRICは、 高出力部分に使用されるCMOSを持つ1マイクロメーターの复細加工によるNMOSに実施され ている。 2 つの出力ピン 8 1 及び 8 2 が 3 ポルト と接地電位で使用される。

更に、本実施例はRIC上にクロック発生器を 設置し、2つのクロック入力(ピン 79及び 80) の間にのみ結晶を設置する必要がある。その代わ りに、所望の通り例えば多重 RICを使つたシス テムに実施する場合では、外部クロック回路をと れらのピンと接続することができる。

第37図から第41図は、1つ又は2つ以上のRICチップを使つて与えられたある特定な構成を示す。 第37図は、16ピットパイプラインRIC構成を示す。 パイプラインプロセスは4段のプロセスにのみ限られるわけではなく、 追加のRICをいつしょに連結することで選むだけの数の段を含むことができることに注意してほしい。

第38図は、32ピットパイプラインを示している。プロセッサPR1及びPR2は、プロセッサPR1及びPR2は、プロセッサPR1及びPR0と同様ロックステップで接続されるととに注意して欲しい。また、2段のペイプラインのみが示されているが、単に充分な数の

桁上げノ桁下げ信号及びシフトノ循環高ノ低信号を除き状況ポートの全てのピンを接続して特定のステージを作り出すことによつてつけかえらの信号は、ワイヤーANDでいつしょに接続されるの時達正に機能する。桁下げ信号はピンの中の大に最高で出て、大変のでは、フトノ循環高に立ったが、最高では、大変のでは、大変には、大変のでは、大変を表している。

RICチップを連結するだけでパイプラインの段をいくつでも望みの数にすることができることも 注意していなくてはならない。

第39図は、64ピットの外部ロックステップ パイプライン構成を示している。R I C A のプロ セッサ P R 3 及び P R 2 及び R I C B のプロセッ サPR3及びPR2は、全てのプロセッサーPR1 及びPROと同様にロックステップで接続される。 無 3 9 図において、両方の R Ι C から接続する 3 2 ピット出力は、それぞれの単一を 1 6 ピット アータポートにおいて、多重化されているものと して示している。とれはパイプライン構成の中の 1つのアータポートは、前の段から与えられたア ー々を受けとる為に必要とされるからである。異 るチップ上のプロセッサPR3及びPR2を含む ように外部ロックステップ構造の大きさを拡大す ることによつて、より大きなパイプラインを作る ことさえ可能である。故にパイプラインワードの 規模は、32ピットインクレメントまで拡大する ことができる。32ピットのインクレメントは、

テージ構成は、4クロックサイクルよりむしろ2クロックサイクルでデータ転送を実行している。 しかしながらこれによつて、32ピットの転送を 可能にし多重ステージパイプラインのステージの 他のペアとの間を並列にする別々の絶縁されたス ィッチの組が必要になる。故に、多重16ピット ポートを使用した方がはるかに簡単であり、一般 的に好ましい。

第41図は128ピットの大規模ハイブリッドロックステッププロセス実行累子を形成するように接続された2つのRICチップを示している。内部的には各々のチップの上の4つのプロセッサーはロックステップで接続されている。各々のチップ上に1つだけの状況ポートが使用されて図で、テナーのサップ間にロックステップを形成しているので、いずれかの多重化法によって64ピットの規模にした同様のハイブリットプロセス実行案子を構成することが可能である。

多重RIC構成において、割込み操作通信網を使り樹系図を用いることでのその融通性及び複雑

性をさらに増加することができる。

以下の3種の割込みは、一定の集積形式で取り扱われる。(1)チップ内部割込み: これらの割込みのソース及び割当てプロセッサは同一RICチに存在するのでこれらの割込みが1つのRICチップ上で発生し完全に同一チップ上で処理される。(2)チップ間割込み: これらの割込みのソースで存在している。(3) I/O割込み: これらの割込みは I /O 装置で発生し、1つ又は2つ以上のRICチップ上に存在するプロセッサに対し行われる。

チップ内部割込みは通常チップ上でダイナミックを再構成を行う為に使用される。例えば、内部的ロックステップモード又はイイプラインモードのオペレーションを実行させる為に使用される。内部的な割込みは、同じRICチップ上の他のプロセッサからサービスを受ける為にも使用される。チップ内部割込みは多重チップ構成に於て重大な役目を果たしており、チップ外又はチップ内のロックステップパイプラインモードのような機々な

多重モードを開始させる為に使用している。チップ間割込みも、異るチップ上に異るプロセッサが使用される時に、多重プロセッサの顔様におけるプロセッサ間の通信を行う為に使用される。一般的を例は、異るチップ上に形成された中央プロセッサ及び 1 / 0 プロセッサ及び 1 / 0 プロセッサ及び 1 / 0 プロセッサ及び 1 / 0 プロセッサ及び 1 / 0 である。中央プロセッサ及び 1 / 0 である。「/ 0 である。中央プロセッサ及び 1 / 0 を置いている。「/ 0 を置いている。

故に、チップ上のどのプロセッサも3種類のソースから割込みを受けとる可能性がある。: 同一チップ上の他のプロセッサ、又は異るテップ上のとれかのプロセッサ又は! / 0 装置からの割込みである。以下の集積割込み機構は一定の型式でこれらの割込みを処理している。いずれかの割込みに応答して、割当てプロセッサの割込み管理回路12は対応するスケデューラ16に指示して割込みの優先順位及び現在実行中のプロセスの優先順

位に従つて適当なプロセスのスケアユールを行う。 上記で示した様に、各々のRICは外部割込み管理回路 7 6 を有し、この割込み管理回路が外部 ソースから受取つた割込みの受け取り、記憶及び 内部プロセッサへの通知を管理していて、内部プロセッサによつて発生された外部割当て先に対す

る割込みの送信も管理している。

るチップ間割込み、即ちクラスォー内部割込みを 容易に操作することができる。このようなパスは 「クラスター割込みパス」と呼ばれ、第42図に 示されている。とのパスはまたクラスター内部で 発生し、クラスタ外部に割当て先を持つクラスタ 一即ちクラスター間割込みを運搬している。同様 にパスはクラスター外部で発生し、クラスター内 のチップの内の1つに於るあるプロセッサに割当 てる I / O 及びクラスォー間割込みの連搬に使用 されている。この階級的機構をもつと有効に利用 する為には、割込み管理回路218が加えられる。 この割込み管理は外部割込み管理回路76がRIC チップに対し行つていたと同じ役めをクラスター に対し行つている。故に各々のチップ216の外 部割込み管理回路76は、クラスター割込みパス 2 1 4 及びクラスター割込み管理回路 2 1 8 とイ ンターフェースしていたくてはたらたい。

クラスター割込み管理回路 2 1 8 の第 1 の機能は、クラスター割込みパス 2 1 4 と クラスター間及び 1 / 0 の割込みの間のインターフェースとし

て働くことである。故にクラスター内で発生した クラスター間割込みは、クラスター割込みパス 214及びクラスター割込み管理回路218を介 し外部クラスォーに送られる。同様に、クラスタ 一外部で発生したがクラスター内にあるチップを 割合て先にするクラスター間及び1/0の割込み は、クラスター割込み管理回路218及びクラス ター割込みパス214を介し割当てチップに送ら れる。クラスター割込み管理回路218及びクラ スォー内にある(例えば)4つのチップはクラス ォー割込みパス214を共用している。 クラスチ 一割込みペス214に関する仲穀方針は、ラウン Pロピンに限られない。RIC割込みインターウ エース 7 6 によつて外部的な制御方法によつて仲 **敷を行りことが可能である。故に違う仲穀機構を** 必要とするクラスターは、それぞれの持つ各々の タラスォー割込み管理回路218内にその機構を 設けている。クラスメー割込み管理回路218は 優先順位又は位置に基づくような仲隶方法を使用 するとともできる。優先順位に基づく仲裁方針を

とつた場合、クラスター割込みパスを共用する全 ての競争者(即ち、チップ216及びクラスォー 割込み管理回路218は、チップ外部に存在する パス仲裁論理に(他のチップに送る為の)割込み の優先順位の判断をゆだねている。そとで仲裁論 理が最も高い優先願位を持つ競争中の割込みソー スを決定しパスの制御をまかせる。位置に基づく 仲裁方針が使用される場合、パスの使用権につき 粉争が起きた場合、クラスダー内部の競争者の位 置が誰にバスの支配を与えるかを決定する。例え は第42図では、位置に基づく方針を使つて決定 する場合、争いが起つたならばクラスター割込み 管理218が常に第1の優先順位を持つとするこ とがてき、それぞれチップ 0 、 1 、 2 、 3 が続く。 殷計者は、考想中の応用に適合するようにもつと 複雑を仲裁方針を自由に選択することができる。 しかし、優先順位に基づくようなより複雑を方針 にはチップ外部にかなりの論理を必要とするが、 ラウンドロピン又は位置に基づくよりを簡単を方 針はチップ外部に非常にわずかな論理を用意する

だけで使用できる。

この点で生まれる明らかな愛問点としては、 2 つ以上のクラスターを持つシステムでいかにして 管理を行うかということである。これらのクラスターは、自分のクラスター割込みペス及びクラスター 割込み管理回路を介しクラスター間割込みを 送つている。さらに階級的組織による管理機構を 発展させて、一組の(例えば4つの)クラスター

を「マクロクラスター」と呼ぶことにする。マク ロクラスター222内のクラスター220は、 「マクロクラスター割込み管理回路」226に接 税する「マクロクラスター割込み リス」224を 共有している。マクロクラスター割込みパス 224 及びマクロクラスター割込み管理回路226はマ クロクラスター222内に於て、クラスター割込 み バ ス 2 1 4 及 ぴ ク ラ ス タ ー 割 込 み 管 理 回 路 218 がクラスター内部で行つていたのと同じ役目を果 たしている。我々は、上の考え方をさらに発展さ せることができる。故に(例えば)4つのマクロ クラスター222で次に高いレベルになるような 奥在を作りだすと考えることができさらにそれ以 上発展させるととも可能である。最後に、好きな 数だけレベルを設けた後で割込みを転送するパス を共有する(例えば) 4 つのサブシステム 2 3 4 まで拡張し、これらから成るシステムの段階まで 違するととができる。とのパスはシステム割込み パス232と呼ぶ。

第43回は、サアシステム0及び1である2つ

特開昭58-58672(42)

のサプシステム234から成るシステムを示して いる。サプシステム1は、マクロクラスター0及 び1を含んでいてサフシステム0は、ただ1つの マクロクラスター即ちマクロクラスター0を含ん ている。サプシステム1のマクロクラスター.0 は 4つのクラスターから成り、サアシステム1のマ クロクラスター1は2つのクラスターから成りサ プシステム 0 のマクロクラスターは 2 つのクラス メーから成る。各々のクラスターは4つのチップ を有している。この例ではサプシステム1は1つ だけのマクロクラスターを有している。故にとの マクロクラスターの割込み管理機能はサブシステ **40の割込み管理に委託することができる。これ** によつてサアシステム 0 ではマクロクラスター割 込み管理回路及びマクロクラスター割込みベスを 除くことができる。ことでは、倒込みの階級的樽 造の考え方を示している。

第44図では、割込みの階級的構造の考え方を示す樹系図を用いて第43図のシステムが示されている。RICチップ216内のプロセッサ PRO

ツブ 7 6 、 クラスター 2 1 8 、 マクロクラスター 2 2 6 … … サプシステム 2 3 0 の割込み管理回路 は次々とより高くなる各々のレベルに存在する。 とれらに1、2……nと番号がついている。プロ セッサーは、その完全な「アドレス」を与えると とによつて即ちシアシステム……、マクロクラス ター、クラスター、チップ及びプロセッサを規定す ることによつてプロセッサーを完全に規定すると とができる。故に各々のアドレスは、サプシステ ム……マクロクラスター、クラスター、チップ及 びプロセッサを区別する為の構成部を有している。 我々は、このアドレス構成部に同様に階級的組織 のレベルを与えることができる。プロセツサ PRO - PR 3 を規定するアドレス構成部は、最下位階 級即ちレベル0とする。チップ、クラスター、マ クロクラスター、……サプシステムを特定するア アレス構成部が次々と高くなるレベルにそれぞれ 異する。これらはレベル1、2……nと名づけら れている。

チップ内のプロセッサ間割込みは、最も頻繁に

- PR3は樹果図の最下位階級に存在し、木にたとえるなら「葉」の部分にあたる。次に高い段階にはRICチップ216を示す節がある。その次の2つの段階にある節はクラスター220、その上はマクロクラスター222を示す。最後に樹果図の根元では完全なシステム全体を示している。

樹系図にはレベルに番号をつけることができる。 プロセッサはレベルのとする、引き焼きより高い レベルに存在するチップ216、クラスター 220 マクロクラスター 2 2 2 は、それぞれレベル1、 2、3 ……… n で示すことができる。 同様にして 別込みの階級におけるレベルにも番号をつけることができる。 割込み パスに関しては、チップ がった とができる。 割込み パスに関しては、チップ がった をする。 クラスター 2 1 4、マクロクラスター 2 2 4、 ……… サアシステム 2 2 8 及びレベルに存在する。 クラスター 2 1 4、マクロクラスター 2 2 4、 ……… サアシステム 割込み パスは な 々と高くなる各レベルに存在する。 これらはそれぞれ 1、 2 … … n と番号がつけられる。 プロセッサーの割込み管理回路 1 2 は最下位レベル即ちレベル 0 に存在する。チ

起とる割込みであると予想されるのでこれらの割 込みの通信及び処理は一般的にできるだけ迅速に 完了したくてはたらたい。上記に示した通り、1 つの割込みについてのソース、割当て、優先順位 及び関連ランタイムに関する情報は、一度ソース プロセッサがチップ割込みパス88の支配を握る とちよりど1ペスサイクル内で通信される。クラ スタ内でのチップ間割込みは2番目に一般的な割 込みであると予想される。本発明の割込み組織で は、クラスター割込みパス214を使つてソース プロセッサからのソースチップ 2 1 6 及びプロセ ツサPRO-PR3、 割合でチップ及びプロセッ サ優先性及びランタイムを確定する情報をクラス ター 割込み管理回路 2 1 8 に 8 パスサイクルで通 信することが可能とたつている。マクロクラスタ 一内のクラスター間割込みはその次に最も一般的 な割込みであると予想される。本発明の割込み組 鍛では、ソースプロセッサからの割込みに関して のソースクラスター、チップ、プロセッサ、およ び割合てクラスターチップ、プロセッ サ および

優先性及びランタイムを確定する情報は、マクロクラスター割込みパスを用いて10パスサイクルでマクロクラスター割込み管理回路226に通信可能となつている。次々と高くなつてゆる間での同様の情報の通信には、レベルの高くなるごとに2パスサイクルのみ追加した期間が必要となる。

スを介しレベル(1 - 1)の他の割込み管理回路に移動するかのいずれかである。例えば、第44 図の割込み3は割込み情報がサプシステム1内を移動している間は上昇フェイズである。割込み情報がサプシステム1の割込み管理回路からファムのの割込みで理回路がサプシスでサプシステムの内を移動する間、情報が割当で先プロセッサに到達するまで非上昇フェイズが経続する。

上記の割込み3のように、ソース及び割当て先プロセッサが異るサアシステム内に存在する場合、割込み情報は最長距離を移動し、最長の時間を要する。一方、割込み1のようにクロセス及び割当でを受ける。故に、一番もまり発生しない割込みが通信又はプロセスに存在する。といましない問題を要する一方最も頻繁に発生する割とのは最短時間で通信及びプロセスが行われる。とのはましい利点が割込みの階級的組織から直接しい利点が割込みの階級的組織から直接しい利点が割込みの階級的組織から直接しい利点が割込みの階級的組織から直接しい利点が割込みの階級的組織から直接して

割込みるは、サプシステム0のマクロクラスター 内の クラスター 0 に属するチップ 1、2、及び3 上のPR0で発生する。割込み情報は一番下の 「葉」から開始し、必要な限り上まで移動してゆ く。即ちレベルを上に上つてゆき、久に釆凶を下 まで下つて割あて先プロセッサを示す「策」の部 分まで選する。割込み情報が樹系図内を移動する ・時間内における割込みの移動を我々は、2つのフ エイメに区別している。これらのフェイズは、 「上昇」フェイズ及び「非上昇」フェイズと呼ば れる。上昇フェイズの期間中、割込み情報はきち んと樹系図を上つてゆく、即ち、情報がレベル! の割込み管理回路からレベルトの割込みパスを介 レレベル(1+1)の他の割込み管理回路に移動 する。非上昇フェイズでは、割込み情報は、系図 の间じレベルを移動する、即ちレベルトの割込み 管理回路からレベルトの割込みパスを介しレベル 1の他の割込み管理回路に移動するか、あるいは また系図の下に向つておりてゆく即ちレベルーの 割込み管理回路からレベル(1-1)の割込みべ

生じる。

割込みの上昇フェイズの間、割込みはレベルトの割込み管理回路から送られる。割込みは、レベルトの割込みパスを介し割込みの階級的組織の樹系図を上に上つてゆきレベル(1+1)の割込み管理回路に達する。上昇フェイズ期間中の割込みの移動は、第45図に示されている。

当て先としておりている。というでは、いくの割されていく、のの記されている。との割されている。との割されている。との割されている。との割されている。との割されている。との割されている。とのません。とのものは、いくのとのとない。とのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのは、いくのとのには、いくのといくのには、い

ペスサイクル1から(2n+4)まで: これらのサイクルは、劉込みの割当てアドレス、劉込みの優先順位、及び劉込みのソースアドレスを指定する情報を転送する為に使用される。 劉当てアドレスは、以下の順で送られる。; サプシステム、…… マクロクラスター、クラスター、チンプ及び

割込みの非上昇フェイズの間、割込みは、レベルーの割込み管理回路によつて送り出され、同じレベルーの割込みがみを動し、レベル(1+1)の管理回路に移動するかわりにレベルーの他の割込み管理回路にゆりなかない。 いてを動する。割込みを動の非上昇フェイズの期間中の割込みの動きも第45回に示されている。

割込みの上昇フェイズ中に使用するプロトコールが第46図に示される。特に、レベルーの割込み管理回路2は、割込みをレベルーの割込みパスを介しレベル(1+1)の割込み管理回路に送りたしている。この割込みの期間中以下の動作が行われる。まずレベルーの管理回路2がレベルーの割込みパスを制御する。

ペスサイクル O について: レベル I のソース 割込み 管理が 割込み情報 線に全て ゼロを送つてレベル (I+1) の割込み管理回路をこの割込みの割

PR即ち、関連するアドレス構成要素の最高のも のから開始して、減少オーダーで階級組織内を下 に向つてプロセスが進行し、PRの認定まで至つ ている。第46図では、サブシステム0、マクロ クラスター1、クラスター3、チップ1及び2、 プロセッサPR2及びPR3が割当て先として特 定されている。割込みの優先順位は127であつ てランタイム情報は34である。側込みのソース アドレスはサブシステム 2、マクロクラスター 1、 クラスター2、チップ3PR0である。とこで関 連する最高レベルのアドレスがサプシステムアド レスであると仮定すると、最悪の場合でもソース 及び割当て先を認定する情報を転送する為には 2 n サイクルが必要とされる。 割込みの優先順位 及びその他関連情報を送信する為には、あと4サ イクルが必要とされる。例えば、最高レベルの関 連アドレスがマクロクラスターまでだけである場 合、マクロクラスター、クラスター、チップ及び プロセッサだけのシーケンスがパスサイクルーか

ら5までで特定される必要がある。 パスサイクル

6及びりは、割込みの優先順位を転送する為に使用され、パスサイクル8及びりは、割込みについてのランタイム情報を転送する為に使用される。 ソースアドレスはパスサイクル10から14で送 られる。

上昇プロトコールと非上昇プロトコールの間には2つの違いがある。1つは、上昇プロトコールでは、割込みが次に高いレベルへと送られるとにないない。非上昇プロトコールでは、割込は次に高いレベルの間でした。2つのプロトコールの間でのもちんに送られる。2つのプロトコールの間での送られる。2つのプロトコールではあられては、最も高いレベルのアドレスが第1に送めれる。これに対し非上昇プロトコールでは般的組織の中で次のレベルがアドレスされて送られている。

以下の例でこれらのプロトコールをより具体的に説明する。サブシステム、マクロクラスター、チップ及びプロセッサPRから成る階級的組織を

テーナルる

外部からチップへの割込み通信

使用中の割込みパス ソース及び割当て先を確定する 情報を転送するシーケンス

上昇フェイズ

クラスターパス サナシステム、マクロクラスタ ー、クラスター、チップ、プロ セツサ

マクロクラスターパス サナシステム、マクロクラスタ ー、クラスター、チップ、プロ セツサ

サプシステムパス サプシステム、マクロクラスタ ー、クラスター、チップ、プロ セツサ

システムバス サプシステム、マクロクラスタ ー、クラスター、チップ、プロ セツサ 持つシステムを考えてみる。あるサプシステムで発生しどれか他のサプシステムに移動するよう割当てられた割込みは、テーブル3で示すように階級的組織の中で移動する。テーブルは各々のレベルでの(我々はチップ外の割込みプロトコールについて説明を行つているのでレベル1から始まっている)割込みテータパス上の割込みの運行を示している。

テーブル3は、以下の点につき添している。割込み非上昇フェイズが開始するととは、割みが階級的組織の中で登る必要のある一番上のレベルをを意味する。テーブルに示される場合では、その最高位レベルはシステムのレベルのの第1の間では、その最高ででは、といるのの非上昇フェインの間アドレスの第1の構成がで示すしている。例とは、サフシステムを確ないとマッチする。例とは、サフシステムを確ないとマッチする。例とは、サフシステムを確定するアドレス構成部もレベル3である。

非上昇フェイズ

サプシステムパス マクロクラスター、クラスター、 チンプ、PR、サプシステム※

マクロクラスターパス クラスター、チップ、PR、サ プンステム $^{\times}$ 、マクロクラスタ $^{\times}$

クラスターペス チップ、PR、サブンステム[※]、 マクロクラスター[※]、クラスタ _※

※ とのアドレスは割込みの割当てを決めるのには必要ない。故に割当てパス上を送信されない。

割込みの移動が非上昇フェイズの期間中、割当 て先を認定する情報のシーケンスは、割当てアレス標成部を左にシフトレス構成部を左にシフトせよ」というオペレーションの実行によつて容易に導き出される。このことは、割込み管理のが一手渡された割込みの割当てを認定する情報のシーケンスを構成する為の簡単なアルゴリズムを構成 する為に利用される。 割込み管理回路がバスを制御するようになると、 第100サイクルで割合て先の割込み管理回路が決定されることを思いだしてほしい。 テーブル 3 で示す通り、 割込みの非上昇フェイズ期間は、 割当て先割込み管理回路は第10 アドレス構成部によって容易に決定することができる。 割込みの上昇フェイズ期間では、 割当てバス上に全てゼロを送信することによって決定する。

割込み管理回路によつて実行されるオーパーオール機能は以下の通りである。我々は、レベルーの割込み管理回路を最初念頭において説明を行う。

一方でレベルーの割込み管理回路がレベルーの割込みでスとインターフェースし、また一方ではレベル(1-1)の割込みパスともインターフェースしている事を思いだしてほしい。これらのパスは様々な方針によつて仲裁が行われる。これらの方針の典型的な例はラウンドロピン、優先性の順によるもの、位置順によるもの等である。チツア割込みパス88はラウンドロピンの順序で仲裁

の維持の方が簡単であるが、好ましい割込み管理 回路は、優先順位に基づく方針で待ち行列を維持 している。優先順位に基づき待ち行列の管理を行 り場合、行列の中での到着時間の順にかかわらず、 行列の最前列にある割込みがその列の中で最も高 い優先性を持つ。

情報状况信号は、いつアドレス情報が送信されるかを示している。上記で示した通り、割当てアドレスが最初に送られ次に割込みデータ及び割込みで思いる。割込み管理回路は受取つた割当てアドレスの数を計数している。との数及び割込み階級に於るそのアドレスの数を計数してアドレスの数を計数したのでは、割込み階級に終づって、割込み管理のオーダで送るか(上昇フェイズ)又は「アリンスに領域とよ」というオペレーンを実行するか(非上昇フェイズ)のいずれにするかを決定している。

階級的組織情報網は、RIC割込みポート機能 に対する応用の一例として示されている。この割 が行われる。いかなる割込み管理回路も内外両側からの割込みを同時にうまく処理することが可能でなければならない。割込み管理回路と割込みパスの間のインターフェースを示すプロック図が第45図に示される。

各々の割込み管理回路は、送信される。各々の割込みで保持して保持してのできる。のののでは、、というのでは、、というのでは、、というのでは、、というのでは、、というのでは、、というのでは、、というのでは、、というのでは、、というのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、はいいのでは、はいいのでは、、といいのでは、、といいのでは、、といいのでは、、といいのでは、、といいのでは、、といいのでは、、といいのでは、、といいのでは、、といいのでは、、といいのでは、、といいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいいのでは、

込みポートは、割込みトポロシー及び割込みプロ トコールによつてまつたく一般的なものである。 階級的組織割込み情報網は、情報網のある形態 にすぎない。この情報網の中では、トポロギーに 関しては変化させることが可能でこのことがRIC の外部割込み管理回路に影響し、2種類の変化を 生む。第1の変化はレベルの数が変わると、情報 網の中のアドレスの長さが変化することである。 アドレスの長さが変化すると割込み管理回路内の パッファスペースも変化する。パッファスペース の変化は、RIC内に含まれていない割込み管理 回路のハードウェアの設計を適当に変えることに よつて操作することができる。トポロソーの変化 によるもう1つの変化は、有効アドレスの組に関 して起こる。この変化も、RICの外部割込み管 理回路を使つてプログラムすることによつて又は 他の割込み管理のハードウェアの仕様を変えると とによつて操作される。

上記説明は R I C のみを有する削込み情報網に 限定されて示してある。しかしながら、チャンオ ル、テイスク、プリンター及び通信網インターフェースといつたようをあらゆる I/O 装置を含む情報網にも同じ様に応用することができる。 この応用性を保持する為に唯一必要とされることは、

I/O 装置がRIC 割込みポートと接続可能なインターフェースを有しているということだけである。

以上のように当初の目的を達成し、一般的な構造を持つICを再構成可能にして使用者のニーズにあわせたカスタムなICを安価に提供することができる。このような再構成可能な機能を持つことで本発明はICにより新しい大きな応用の可能性を持たせることができると確信する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の再構成可能;Cの概略的全体図である。

第2図は、1つのプロセッサを全体的に含み各 各の種類の外部インターフェースの内の1つを含 むRICの部分的な平面図である。

第 5 図は N O R ケート仕様として実施された D L A の A N D 及び O R マトリクス 部分を示す部 分図である。

第4図は、ゲート仕様と名前のついた実施例であるDLAのAND及びORマトリクスの部分を示す図である。

第5図は制御パスの構成を示す図である。

第6図は、中央制御記憶制御回路と4つのモデュール制御回路の間の関係を示す図である。

第7回は、中央制御記憶回路がアクセスされた場合の中央制御記憶回路及びそれぞれのモデュール制御回路のオペレーションを示すフローチャートである。

第8図は、花輪状に連結されたペス使用可能線の接続を示す図である。

第9図は各々のプロセッサ内のALUの主要部分を示す概略図である。

第10図及び第11図は、それぞれ各々のプロセンサ内の機能プロック及び桁上げ連結プロック 部分の回絡図である。

第12図は各々のプロセッサ内のパレルシフタ ーの構造を示すフローチャートである。

第13図、第14(a)、14(b)、及び14(c)図は、各々のプロセッサ内のパレルシフタで実行されるシフト及び/又は循環オペレーションの例を示すで実行される抽出オペレーションの例を示す。で実行される抽出オペレーションの例を、 図であり、第15図はパレルシフタ/示す図である。

第16図はアータバスの構造を示す図である。

第17図は、アータパスのプロトコールを示す 図である。

第18図は、各々のプロセッサ内のデータパスのプロック図である。

第19図はRICの内部RAMシステムを概略 的に示す図である。

第20及び21図はそれぞれのバス制御ユニットの構造及びオペレーションを示す図である。

第22回は、メモリスケアユーリングユニット のオペレーションを示すフローチャートである。

第23図~第25図は隣接するプロセッサの再 構成された異るモードに対応して状況マルチプレ クサが操作を行う状況パスの内部接続を示す図で ***

第26図、第27図及び第28図は、それぞれ

独立モードロックステップモード、パイプライン モードにおけるRIC内のアータ及びコマンド命 令の流れを観略的に示す図である。

第29図は、各々のプロセッサ内のスケデュー ラ及び割込み管理回路のプロック図である。

第 3 0 図は、各々のプロセッサ内のスケデュー ラのオペレーションのフローチャートである。

第31図は、割込み管理ワードのフォーマット を示す図である。

第32図は、割込みが送られる時の制御記憶ア ドレス銀のフォーマントを示す。

第33図は、プロセッサPR3がプロセッサPR1に対し割込みを送る時の割込みのタイミンクの例を示す図である。

第34図は、RICのピンの配置図である。

第35回は、概略的に内部割込みデータ構造を 示す図である。

第36図は、劉込みが送られている間の外部劉 込み管理回路のオペレーションを示す図である。

第37図~第41図は、2つ以上のRICチッ

プ上のプロセンサを運結することで可能となる構成 の例を示す図である。

第42図は、4つのチップからクラスタまでの 組織を示す図である。 (a及び43b)

第4 3V図は、多数のRICチップが結合された 階級的組織を持つシステムを示す図である。

階級的組織を持つシステムを示す図である。 a及びb 第44図は、第43図で示した多重チップ組織 に相当する樹系図である。

第45回は、第45回及び第44回で示したよ 5に階級的組織内の不特定をレベルにおける劉込 みレベル管理回路及びパスのオペレーションを振 略的に示す図である。

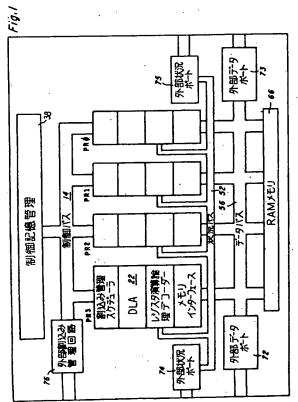
第44図は、第43図及び第44図と同様の多 重テップ階級的組織において削込みが上昇フェイ メである時の情報プロトコールを示すタイミング 図である。

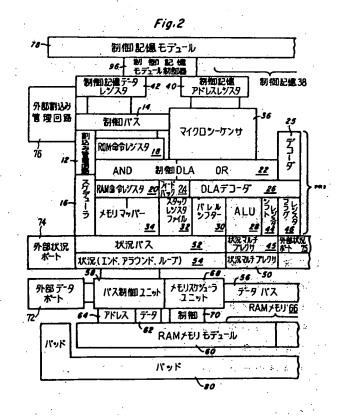
第41図は、各々のプロセッサ内に含まれるマ イクロシーケンサのプロック図である。

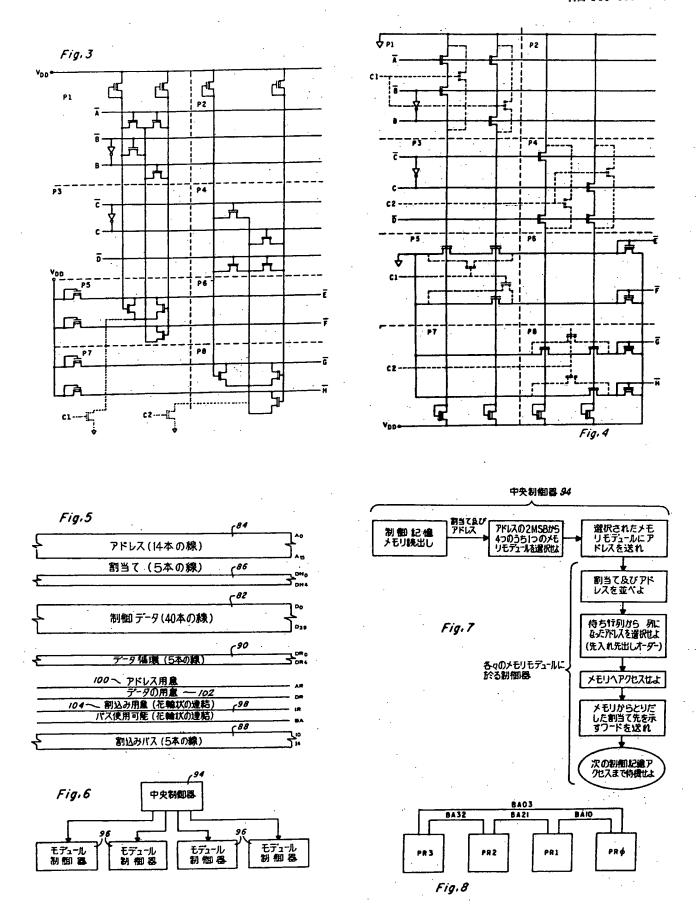
符号の説明

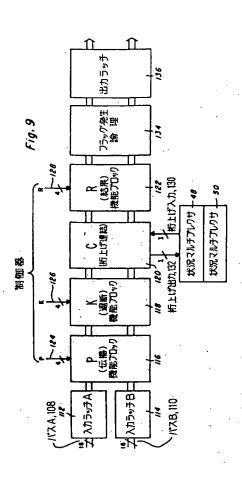
理回路、14…制御パス、52,54…状況パス、56…データパス、16…スケデューラ、22… 制御DLA、28…ALU、36…マイクロシーケンサ、38…制御配億回路、45,50…状況マルチプレクサ、60…RAMメモリモジュール、68…メモリスケデューラユニット、72~76…外部インターフェース。

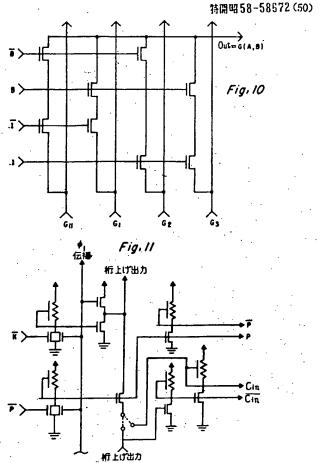
図面の浄欝(内容に変更なし)

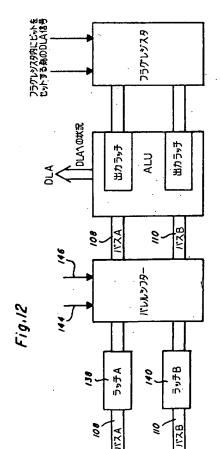


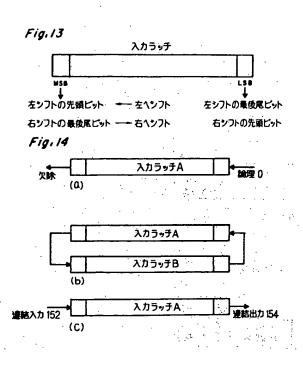


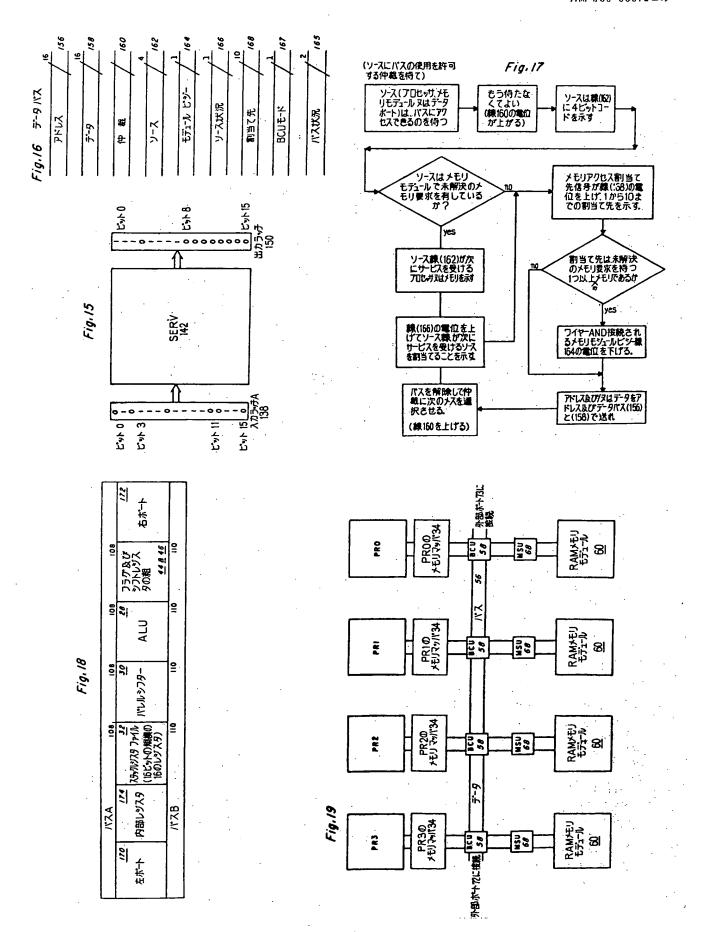


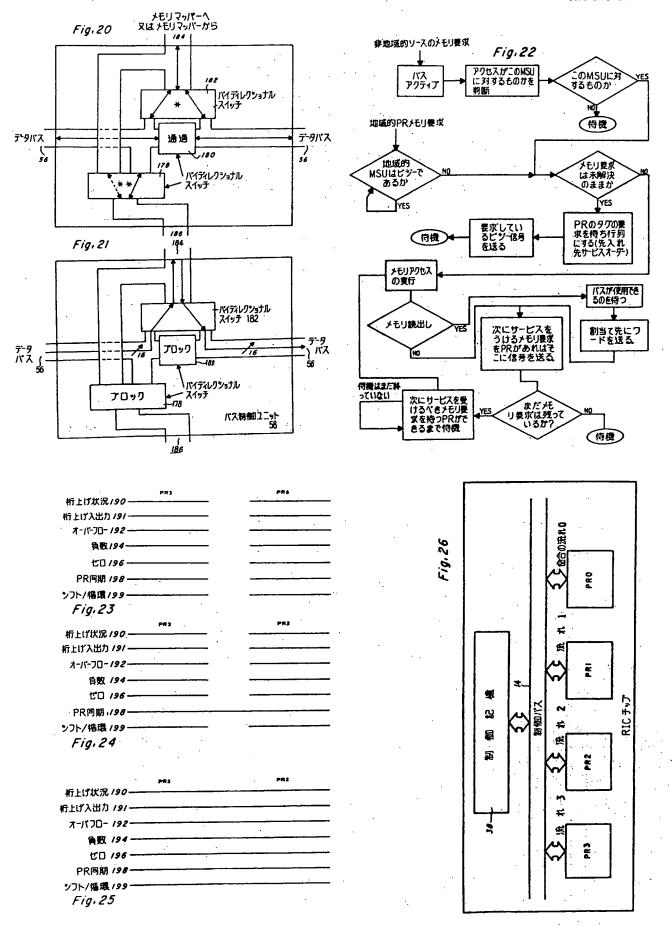


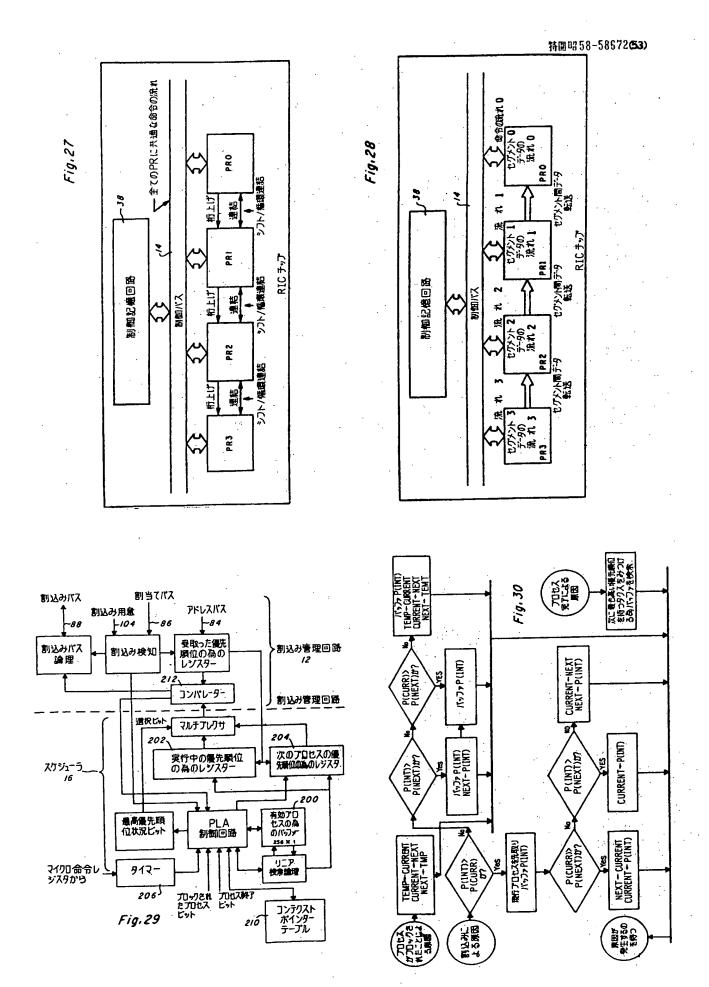


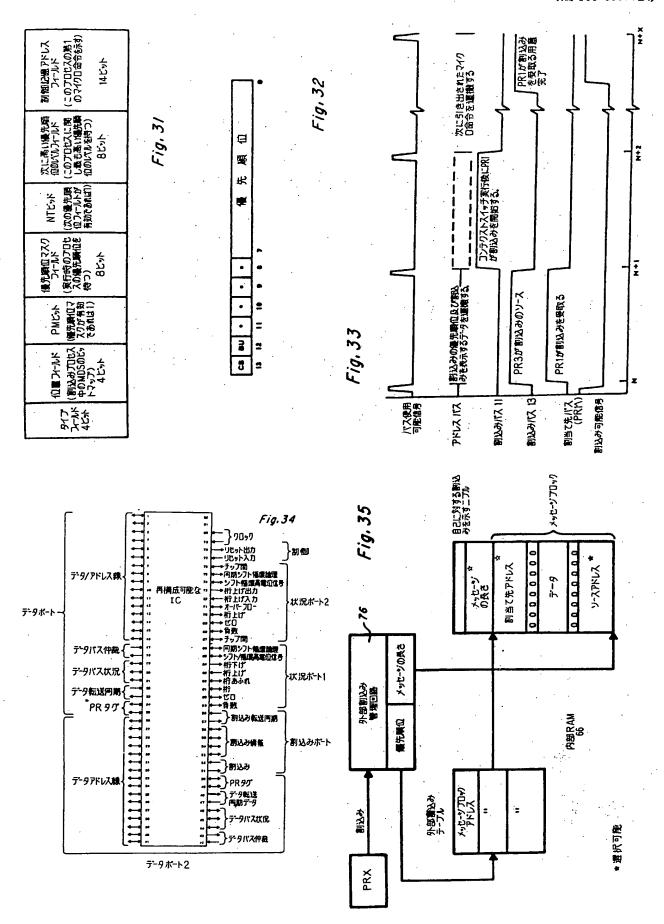


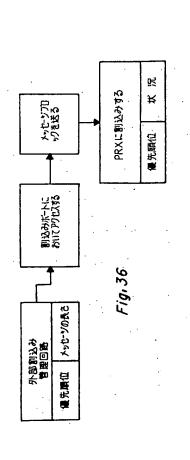


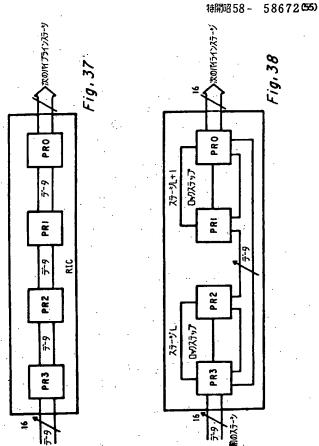


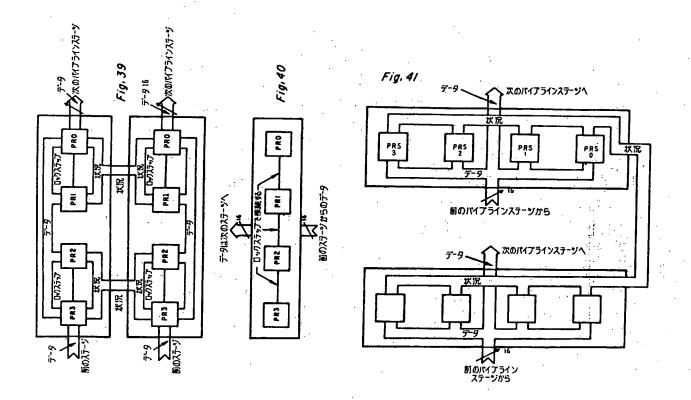


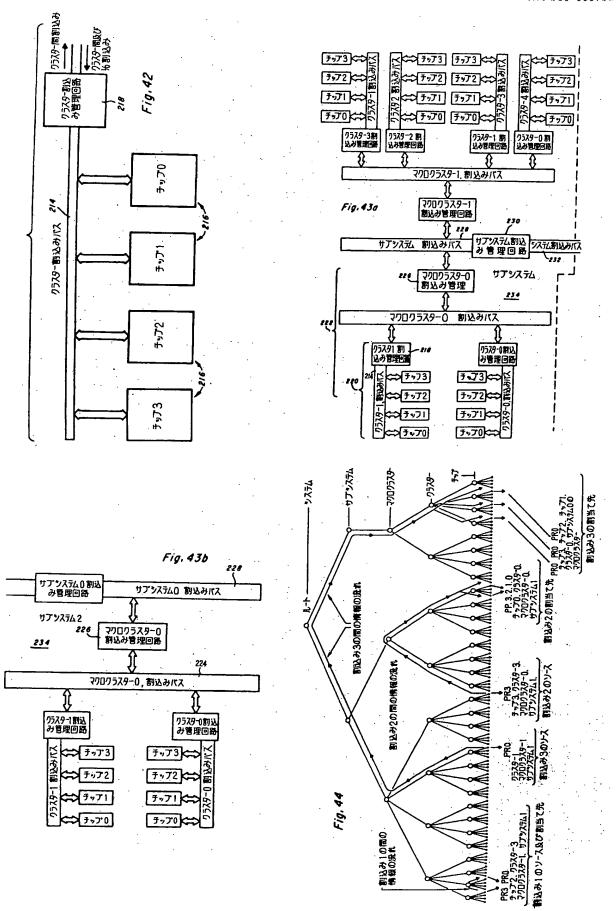


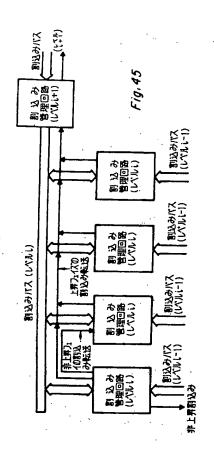


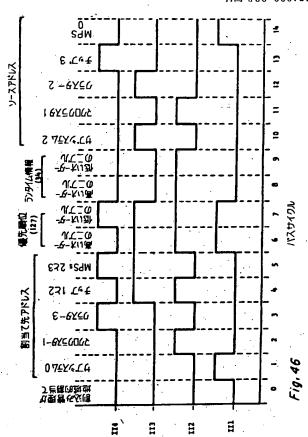


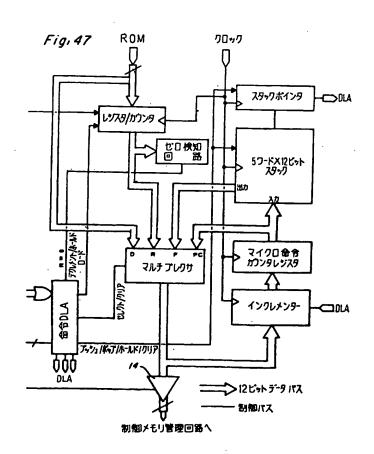












手 続 補 正 書 (方式) 57.10-7

特許庁長官 殿

圃

- 1. 事件の表示 昭和 57 年 特許顧 第 / 28805 号
- 2. 発明の名称 再構成可能集積回路
- 3. 補正をする者

事件との関係 出願人

名 称 テキサス インストルメンツ

4. 代理人

住所 京京第千代田区北の内ま丁目 5号 1号 (電話 代表 211—8741等)

氏 名 (5995) 弁理士 中 村

を記し

- 5. 補正命令の日付 自 発
- 6. 袖正の対象 全図面



7. 補正の内容 別紙の通り

図面の浄書(内容に変更なし)。

- (1) 明細書第 / / 3 頁第 / 行に * 示す。 * とあるを「示す。ととでピット 1 3 にかける C S が / のときは金部のコンテクストスイッテを、 C S が 0 のときは部分的なコンテクストスイッテを、 またピット 1 2 にかける B U が / のときはすぐ にプロセスされない場合の割込みをペッファナるととを、 B U が 0 のときは割込みをペッファしないことをそれぞれ扱わしている。 」と訂正する。
- (2) 同書第185頁第19行に ある。 とあるを「あり、第23図は独立モード内部接続を、第24回はパイプラインモード内部接続を、第25回はロックステップモード内部接続をそれぞれ示している。」と訂正する。
- (3) 阿春郎 / 8 6 頁路 7 行に * テャートである。 *
 とあるのを次の通り訂正する。
 「テャートであり、 この図に用いられる。
 P(INT)は割込みの優先顧位を、
 P(NEXT)は次に高い優先性をもつプロセスの優先顧位を、P(CUR)は現在実行

手 続 補 正 書 57.10.-7

昭和 年 月 日

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿

1. 事件の表示 昭和 57 年時許顯第 728805 号

2. 発明の名称 再構成可能集積回路

3. 補正をする者

事件との関係 出願人

名 称 テキサス インストルメンツ インコーポレーテッド

4. 代 理 人

住 所 東京都千代田区丸の内3丁目3号1号(電路代表 211-6741号)

氏名(5995)弁理士中 77



5. 補正命令の日付 自 発

7. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の書からび図面の簡単な説明の書

8. 補正の内容

中のプロセスの優先順位を、NEXTは次にスケアユールしたプロセスの優先順位を持つレジスタを、CURRENTは現在実行中のプロセスの優先順位を持つレジスタを、TEMPは一時的なレジスタを示している。」

(4) 明細書中、下配各個所の誤記を夫々訂正する。

頁	打	異紀	訂正
109	18	#1 * 0	タイプの(0000)
₽ .	20	£171	1171(0001)
110	1	2	2(0010)
184	/	である。	であり、通常の区面を持つダ イナミック論理配列を示して いる。
•	10	フェー	制御配憶メモリ管理のフロー
	17	機能	ALUの機能
185	10	RIC	再構成可能IC(RIC)
186	1	独立モードロツクステ ップモード	独立モード、ロッタステップ・モ ード

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

2
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.